

業 務

概覽

我們是誰

我們是中國領先的功率器件及音頻芯片供應商，已建立涵蓋設計、生產工藝開發及銷售的一體化業務架構，橫跨多個終端市場。藉此，我們專註於為汽車、消費電子以及能源及工業(包括AI數據中心電源)市場提供高品質及高續航的功率器件及音頻芯片。

根據CIC的資料，我們是中國唯一採用虛擬IDM模式開發功率器件及音頻芯片的半導體公司，實現工藝反哺製造，產能動態優化，並與晶圓廠緊密合作，構建技術定義權、供應鏈自主權及品質主導權在內的綜合競爭優勢。

我們的功率器件產品是電能轉換與電路控制的核心元器件，確保電力電子器件在新能源汽車、人工智能數據中心供電系統以及能源電氣化等眾多關鍵應用中的卓越性能。憑藉強大的技術和創新能力，我們已通過相關驗證，成為多家全球領先汽車企業的核心供應商，展現了我們在中國汽車功率器件行業的領先技術地位。同時，我們也提供音頻芯片，包括MEMS產品和信號鏈芯片，透過結合先進的算法，能夠有效滿足各種智能設備的複雜音頻處理需求，涵蓋音頻信號的採集、轉換和處理。

我們的競爭優勢

國內領先功率器件及音頻芯片提供商，錨定行業變革機遇，廣獲頭部客戶認可

當前，全球產業正經歷從以電氣化為特徵的發展時期邁向深度融合人工智能所塑造的新時代。這一轉變為汽車、能源與工業與AI三大關鍵領域帶來戰略性機遇，這些領域日益複雜的電力傳輸與信號處理挑戰，持續推動我們兩大產品類別(功率器件與音頻芯片)的強勁市場需求。

汽車領域是全球功率器件市場最大份額。根據CIC的資料，汽車領域功率器件的全球市場規模從2020年的73億美元增長至2024年的135億美元，2020年至2024年間年複合增長率達16.8%，預計到2029年將達到245億美元，2024年至2029年間年複合增長率預計為12.7%。

與此同時，由於汽車領域對車規級技術要求的嚴苛性及漫長的客戶驗證流程，中國相關產業的國產化率目前仍處於較低水平。根據CIC的資料，2024年中國汽車領域功率器件國產化率少於10%。在此行業背景下，憑藉領先的技術實力與基於深度市場洞

業 務

察的前瞻研發，我們已成功成為多家國際知名汽車客戶在中國境內的少數本土供應商之一。我們的關鍵功率器件產品(包括碳化硅MOSFET產品、硅MOSFET產品及硅IGBT產品)已廣泛應用於新能源汽車電機驅動系統、BMS、車載充電系統、底盤管理系統、車身管理系統、熱管理系統及域控制系統(ZCUs)。截至最後實際可行日期，我們的產品已導入全球十大新能源汽車製造商中的八家及全球前五大汽車零部件供應商中的兩家。

作為數字經濟的核心基礎設施，全球AI數據中心正面臨電力需求激增及隨之而來的電力供應管理挑戰(特別是因訓練與計算任務產生的峰谷週期調節問題)，這使得該領域成為功率器件增長最迅速的市場之一。根據CIC的資料，2024年AI數據中心用功率器件的全球市場規模為7億美元，預計在2024年至2029年間按預期年複合增長率23.9%增長。

由於需要充分確保數據處理的安全性及可靠性，AI數據中心所應用的功率器件必須滿足高性能及高頻率相關的要求，同時具備較高的可靠性及質量。然而，根據CIC的預測，2024年中國AI數據中心電源市場功率器件的國產化率約為20%，顯示出該領域屬於高壁壘且技術難度較大，同時具備巨大的增長潛力，尤其受益於供應鏈本地化的行業趨勢，供應鏈本地化通常會減少響應時間並提升成本效率。憑藉卓越的產品質量及深厚的技術專長，我們提供適用於AI數據中心的全系列功率器件產品。截至最後實際可行日期，我們是國內極少數在該領域實現量產能力的功率器件製造商之一，我們的解決方案已被全球領先的AI數據中心客戶成功採用並量產，有助於我們於數據中心市場的一級電源及二級電源領域獲得業務機遇。

AI正在重塑人機交互，音頻交互因其便捷性成為智能終端的重要控制接口。隨著智能硬件的快速發展，音頻交互的應用領域不斷擴大，涵蓋消費電子、汽車及AI人機交互等領域。根據CIC的報告，全球音頻芯片市場規模(以收入計)從2020年的68億美元增長至2024年的79億美元，2020年至2024年的年複合增長率為3.8%。預計到2029年將達到100億美元，2024年到2029年的年複合增長率預計為4.8%。特別是，機器人領域預計將成為增速最快的應用領域。我們已成功涉足該領域並全面提供音頻芯片產品，包括MEMS產品及信號鏈芯片，該等產品均為針對機器人應用而量身打造。憑藉我們完整的產品組合及強大的技術能力，我們的MEMS麥克風芯片出貨量在2024年達到12億顆。根據CIC的資料，以2024年的MEMS麥克風芯片出貨量計算，本公司位居中國第一位，全球第三位。截至最後實際可行日期，我們已成為多家全球領先智能設備製造商的供應商。

業 務

此外，憑藉我們全面的產品供應、平台化的工藝開發能力，以及優質的產品市場聲譽，我們亦在充電樁、智能家電、光伏儲能及消費電子等市場建立了強大的市場地位，我們已成功為相關行業的多家領先企業實現了大規模量產。

中國的功率器件、音頻芯片行業唯一的虛擬IDM模式運營商，構建穩固高效的合作生態

我們自成立以來一直採用虛擬IDM模式，並成功與我們的股東之一芯聯集成電路製造股份有限公司（「芯聯」）建立了穩固高效的合作生態系統及戰略協同效應。基於我們的緊密合作關係，同時考慮到我們的未來發展前景，芯聯已透過上海芯聯企業管理合夥企業（有限合夥）（該公司於2025年隨後被轉讓至上海芯聯啟辰）對本公司進行少數股權投資，以深化戰略合作並建立穩定的上下游產業生態系統。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司主要股權變動」。根據CIC的資料，截至最後實際可行日期，我們是中國功率器件、音頻芯片行業唯一的虛擬IDM運營商。受益於我們的虛擬IDM模式，我們能夠保持對關鍵專有工藝技術的有效控制，同時利用代工生態系統實現具有成本效益的擴展，並通過外包的標準化製造降低供應鏈風險，使我們能夠針對覆蓋低壓、中壓到高壓的各類產品都能根據不同應用場景進行平台級優化。此外，該戰略定位亦讓我們在快速迭代、定制化驅動的領域（如汽車、能源與工業以及消費電子）中脫穎而出。在該等領域中，快速的硬件迭代與特定應用最佳化是成本、性能及可靠性考量中的關鍵競爭因素。此外，透過深度整合外部優質的晶圓代工、封裝及測試資源，我們已建立了平台化營運系統，推動產品設計與製造之間順暢運作，在保障工藝可控性及產品一致性的同時，大幅提升良率水平，並確保了新平台的使用效率。

根據CIC的資料，芯聯是全球領先的晶圓代工廠。就2024年收入而言，芯聯位列全球專屬晶圓代工廠前十強，並躋身中國第四大晶圓代工廠。在功率器件領域，芯聯是中國最大的車規級IGBT生產基地之一，其碳化硅MOSFET出貨量長期穩居亞洲領先地位。在音頻芯片領域，芯聯於2024年全球MEMS麥克風製造商出貨量排名中位列第二，更是中國唯一躋身全球前五位的MEMS代工廠。我們與芯聯的穩定合作讓我們構建了強大的供應鏈、工藝技術、運營效率、產品良率及一致性優勢：

- **強化並鞏固我們的供應鏈。**通過與芯聯建立的戰略合作關係，實現生產能力的協同規劃與提前佈局，有效且靈活應對市場波動風險，確保產品穩定供應。

業 務

- **聯合研發提升工藝技術水平。**在開發研發項目時，我們與芯聯密切合作，特別專註於開發定制化工藝技術，以有效突破標準代工技術的限制，進而提升產品性能。作為芯聯多個主要產品線(包括碳化硅、超級結MOSFET、分離柵溝槽及MEMS產品)的主要客戶，我們亦就其車規級生產線工藝調試及質量管理體系的開發向芯聯提出建議。這項合作增強了我們產品的獨特競爭力，有助於我們拓展至增長潛力巨大的新興領域，包括汽車及AI數據中心。
- **提升營運效率。**憑藉我們的工藝定制化能力，我們能夠與芯聯開展合作，根據不同產品線的特定工藝需求，設計量身定制的產能排布及批次驗證方案。這有效縮短了從工程轉量產週期及產品設計迭代週期，提高了我們對客戶多樣化需求的回應效率。舉例而言，根據CIC的資料，與芯聯合作開發用於碳化硅MOSFET產品的交付週期較行業平均水平明顯縮短。我們的分離柵溝槽及碳化硅產品的設計迭代週期分別低至2至3個月以及3至4個月，低於行業平均水平。
- **提升產品良率及一致性。**透過設計導入、關鍵工藝節點聯調機制，我們與芯聯集成製造環節協同實現了全過程質量追溯及動態優化。例如，我們自研的碳化硅工藝的平均良率已超過90%，根據CIC的資料，大幅高於行業平均良率。

平台化佈局，全面的產品矩陣滿足多元化需求

根據CIC的資料，我們是中國產品佈局最全面的功率器件平台型企業之一。我們的功率器件產品涵蓋從25V–200V中低壓到650V–2,300V高壓規格範圍，提供了從硅到碳化硅技術的完整解決方案。透過針對特定客戶應用需求量身打造的产品組合，我們提供一站式的功率器件解決方案，滿足汽車、消費電子及能源與工業等多元化下游市場的應用需求。

- **碳化硅功率器件：**我們的碳化硅功率器件產品組合涵蓋從600V到2,300V的主流電壓，彌補了國內高壓碳化硅功率器件應用的空白。該等產品能滿足新能源汽車主驅逆變器及車載充電器以及AI數據中心服務器等關鍵應用的嚴苛要求。本公司自研的8英寸碳化硅平面柵MOSFET產品已完成全流程工程驗證並成功流片，標誌著我們成為國內具備8英寸碳化硅MOSFET設計能力的開創性企業。
- **硅功率器件：**我們提供廣泛的硅功率器件產品，包括IGBT、分離柵溝槽MOSFET及超級結MOSFET，其主要應用於充電樁、智能家電及消費電子快充等領域。根據CIC的資料，我們的全系列最新一代硅功率器件在性能及良率等關鍵指標上已達到全球領先水平。

業 務

此外，我們還提供信號鏈芯片產品，滿足端側AI應用中的音頻信號處理需求，包括MEMS麥克風、ADC/DAC及編解碼器。我們的產品涵蓋從音頻信號採集、轉化到處理與算法的整個音頻信號處理鏈，可廣泛應用於智能手機、平板電腦、耳機、車用系統、智能穿戴、智能家居及智能玩具等領域。我們的產品融入了先進的AI算法技術，全方位滿足各類智能設備的音頻處理需求。

先進的設計工藝及嚴苛的品質檢測，交付高品質、高可靠性的產品

根據CIC的資料，憑藉我們在功率器件及音頻芯片的設計、製造工藝及應用方面的深厚專業知識，多個產品在關鍵性能指標上已達到甚至超越了國際競爭對手。為了進一步確保我們產品的性能及一致性，我們還建立了從設計階段到製造環節，再到驗證程序的全流程質量控制體系，以確保產品的可靠性。

- **硅分離柵溝槽MOSFET**：我們的分離柵溝槽MOSFET產品涵蓋整個25V–200V中／低壓範圍。透過定制化的外延層及最佳的單元結構，結合量身打造的工藝，我們的產品可達到全球領先的性能標準。特別是在25V、30V和80V平台上，根據CIC的資料，我們提供了具有全球領先性能的極低電阻產品。此外，我們的40V和80V器件在服務器電源同步整流拓撲應用中可以達到鈦金級效率標準(服務器／數據中心電源的業界領先之高效能認證標準)。該等產品在加入經特殊工藝優化的反向恢復性能功能後，可實現軟恢復特性，進一步降低與開關振盪相關的功率損耗，並透過抑制電壓過衝應力尖峰來提升安全性。憑藉精密的器件設計與配對工藝，以及優質的封裝解決方案，我們的分離柵溝槽MOSFET產品可在器件性能、穩定性與安全性方面為汽車產業客戶提供卓越的表現。
- **硅超級結MOSFET**：我們採用先進的器件設計和配對工藝來達到更高的性能，包括(i)特殊的器件結構設計來優化動態損耗；(ii)多外延工藝技術實現精確的層結構控制、電荷平衡優化及最佳的缺陷控制；以及(iii)增強器件的堅固性及EMI性能，並降低電路雜訊。該等特性有助於滿足客戶對高效率及低EMI不斷提高的要求，使其適用於廣泛的電源應用場景。我們的超級結MOSFET產品組合涵蓋550–700V電壓規格。根據CIC的資料，我們的超級結MOSFET產品在導通電阻與反向傳輸電容等關鍵參數方面已達到全球領先標準。
- **硅IGBT**：我們的溝槽場截止型IGBT產品覆蓋了主流電壓(650V–1,400V)規格，最大電流可達150A。於2024年，我們推出了650V S3-T系列產品，該產品採用了先進的微溝槽技術，根據CIC的資料，該產品在最後實際可行日期實現了中國業界的先進電流密度水平。同時，該等產品在阻斷電壓及導通損耗之間達到

業 務

了最佳平衡，根據CIC的資料，導通壓降(Vcesat)可與世界一線競爭對手的最新一代產品相媲美。該等產品的背面採用載流子壽命控制技術，實現了IGBT器件的快速軟關斷，在降低關斷損耗的同時，有效抑制了關斷電壓衝擊。

- **碳化硅MOSFET**：我們的平面型碳化硅MOSFET產品涵蓋覆蓋650V–2,300V等主流高壓規格，採用平面式閘極技術與高度可靠的垂直器件結構。尤其是，我們於2025年推出的最新系列G5碳化硅MOSFET實現重大技術突破，在特定導通電阻與寄生電容方面達到國際先進水平。因此，我們的產品具備降低關斷過衝與振盪、顯著提升電磁干擾裕度及高dV/dt耐受能力等特性，支持高速開關應用。此外，該平台新增支持零電壓關斷的產品系列，能顯著改善半橋拓撲應用中的抗串擾特性，並簡化驅動電路設計。
- **MEMS**：我們的MEMS麥克風採用獨特的振膜紋理設計與排氣結構，在維持高靈敏度的同時，提升靈敏度一致性並展現卓越的機械性能。透過專用的背板沉積與背面蝕刻工藝，顯著降低噪音並盡量減少帶電異物造成的故障，使器件具備更高信噪比(SNR)與更強機械抗衝擊性。該技術優勢使產品具備功耗低、體積小、精度高、一致性優、可靠度高，並支持表面貼裝等優點。

此外，我們已成功實現突破性8英寸碳化硅MOSFET工藝技術，定義新行業標桿。推動碳化硅功率器件迭代的主要動力之一是持續進行更大晶圓尺寸升級。目前6英寸襯底依舊是市場主流，但8英寸襯底的市場需求正逐步攀升。我們已精準把握碳化硅襯底從6英寸向8英寸升級的關鍵窗口，並投入相關研發項目以搶佔先機優勢。截至最後實際可行日期，我們自主開發的8英寸碳化硅平面柵MOSFET已完成全流程工程驗證並成功流片。該技術突破標誌著本公司成為國內首批具備8英寸碳化硅MOSFET設計能力的公司之一，相比6英寸晶圓可顯著降低單晶片成本。

我們已建立全流程質量體系，從產品設計開始預防損耗。我們堅持「設計即質量」的理念，依託虛擬IDM模式帶來對器件設計和生產工藝之間動態關聯的深刻理解，構建了貫穿設計階段、製造運營及驗證程序的端到端質量控制體系，確保產品具備卓越可靠性。於往績記錄期間，我們的汽車級產品品質已獲得頂級汽車電池製造商的認可。

業 務

- **設計端：**為精準識別及解決潛在失效風險，我們在版圖設計過程中結合器件關鍵單元冗餘設計、終端結構優化及寄生參數控制。透過執行嚴謹的設計規則檢查及驗證，確保我們的設計在物理實現、電氣性能及製造可行性間達成動態平衡。
- **製造端：**我們獨特的虛擬IDM模式帶來對器件設計和生產工藝之間動態關聯的深刻理解，實現了產品的全過程質量追溯與動態優化。
- **驗證端：**針對應用場景需求，我們定制化實施器件動態驗證，精準識別邊界條件下的潛在可靠性隱患，全面驗證器件魯棒性與動態穩定性。同時，嚴苛的全流程可靠性驗證可以保障產品在高溫、高應力等極端環境下的長期穩定性，為汽車、工業及高端消費等應用場景提供堅實的產品品質保障。

我們擁有深耕半導體行業的人才隊伍，以及具有深厚產業背景的股東支持

我們始終秉持以客戶為中心的企業文化，堅持持續創新、追求卓越的理念，通過技術和產品打動客戶。這一文化貫穿我們發展的每個階段，驅動技術與產品的持續創新。我們深信人才是實現半導體行業可持續發展的核心競爭力，作為知識密集型產業，自創立以來，我們始終遵循管理團隊制定的發展策略，持續投入資源招募並挽留經驗豐富的專業人才。截至2025年12月31日，我們擁有66名研發人員，佔我們員工總數約41.8%，其中碩士或以上學歷研發人員佔比約53.0%。我們的核心研發團隊成員均來自國內外知名高等學府，在功率器件研發領域平均擁有約15年的專業經驗，對行業擁有深刻的理解和豐富的經驗。我們致力於產學研合作，已與中國頂尖院校建立合作關係，強化在功率器件物理與失效機理的研發能力，以及在高可靠性碳化硅器件設計、製造及產業化的前沿技術。

我們的核心管理層均來自半導體行業知名頭部企業的資深專業人士，平均擁有超過15年行業經驗，覆蓋半導體市場與銷售活動、半導體設計、製造工藝及品質管理，為公司技術突破與業務拓展提供堅實支撐。尤其是，我們的創始人及董事長郭博士擁有近20年半導體行業全鏈條經驗，曾任職於上海華虹NEC電子有限公司、中芯國際集成電路製造(上海)有限公司及紹興中芯集成電路製造股份有限公司，從技術研發到企業管理積澱深厚，主導公司戰略佈局，帶領團隊在功率器件、信號鏈等核心領域實現突破，具備豐富的企業運營與行業資源整合能力。

業 務

憑藉雄厚的技術實力與成熟的技術商業化經驗，我們已獲得具有深厚產業專業知識的領先投資者(包括芯聯、三花控股集團有限公司、美的資本、北京汽車集團產業投資有限公司、萬向集團公司及上海汽車集團股份有限公司)的戰略投資。我們大大受益於該等投資者的深度行業洞察、顯著市場影響力以及在相關產品領域應用半導體技術的領導地位。憑藉此優勢，我們能精準評估研發方向及規劃產品發佈，有效把握產業需求演變帶來的新機遇，從而引領市場趨勢，為可持續發展奠定堅實基礎。

我們的戰略

全面擁抱汽車、能源及工業行業發展的歷史性機遇

根據CIC的資料，汽車、能源與工業等行業發展和人工智能驅動的智能數據中心加速部署驅動功率器件產業需求擴張，全球及中國功率器件發展已進入加速滲透的新階段。此外，隨著越來越多的AI終端產品的誕生和普及，人工智能預計將成為音頻芯片行業增長的核心驅動及強勁引擎。我們全面擁抱汽車、能源和AI數據中心行業發展的歷史性機遇，貫徹「創領產品革新，拓建生態版圖」戰略，具體來看：

- **產品創新。**我們擬緊跟汽車電動化和智能化、AI算力需求和終端設備快速發展帶來的市場需求變化，通過內生和外延的方式前沿佈局高效率、高可靠、高集成、高端化的技術和產品，旨在充分把握汽車、能源和人工智能行業發展帶來的歷史性商業機遇。
- **生態拓展。**我們將與上下游合作夥伴緊密合作，共同打造強大的生態圈。該舉措旨在進一步加強客戶黏性，加強我們在行業價值鏈中的戰略影響力。

持續完善虛擬IDM模式建設，加大研發、推動技術創新

為了鞏固國內功率器件及音頻芯片行業的領先地位，我們致力通過持續完善虛擬IDM模式建設，加大研發投入、推動技術創新，以提升我們的能力和運營效率。

- **工藝協同創新。**我們在芯片設計、生產工藝和應用解決方案方面的專業知識和深度協同，是我們能夠提供卓越產品的能力基礎，且大幅提升了我們的市場響應速度和商業靈活性。我們計劃持續深化與晶圓代工廠的戰略合作，促進產品的協同開發與工藝技術優化，確保其精確匹配我們的產品技術路線圖，

業 務

例如聯合晶圓代工廠積極探索超級結碳化硅MOSFET、超高壓碳化硅IGBT以及雙向增強型氮化鎵FET工藝，提升產品的性能和可靠性。

- **效率提升機制。**我們計劃通過與晶圓代工廠深度信息共享與反饋、產能深度合作以及數據保密與互信機制，進一步提升與晶圓代工廠的合作效率。

豐富產品矩陣，提升產品性能，保持行業領先地位

在功率器件領域，在現有重點圍繞碳化硅MOSFET產品、硅IGBT產品和硅MOSFET產品的產品基礎上，我們計劃持續加大第三代半導體的產品線擴展，構建以碳化硅、氮化鎵為核心的平台化優勢，保持在功率器件領域的先發優勢及領先地位。此外，隨著汽車、能源行業的發展和家電行業的新應用，功率器件逐漸模塊化、集成化。我們計劃基於器件優勢開發智能功率模塊（「IPM」），以持續滿足行業需求。我們將持續提升功率器件產品在汽車、工業與消費這三大核心領域的性能。就汽車應用領域而言，針對電池管理、電機驅動、車載充電等關鍵應用，提升產品的可靠性、耐用性和散熱性能，確保在嚴苛環境下長久穩定運行，同時追求更高能效、更快響應速度與更強抗干擾能力。就能源與工業應用而言，注重優化產品的開關損耗與反向恢復特性，以適配服務器電源、通信電源等高頻、高功率、高效率的應用場景。對於消費電子領域，我們計劃聚焦於高能效和小尺寸封裝，提升系統功率密度與成本競爭力，支撐高頻高效、小型化應用場景。

在音頻芯片領域，我們計劃以硅麥克風芯片作為錨點，穿透信號鏈核心環節，構建端側智能閉環。我們計劃豐富MEMS麥克風芯片、編解碼器、MEMS揚聲器芯片、智能音頻SoC等產品矩陣，強化「芯片+算法+開發平台」業務模式，加強音頻芯片、算法和軟件的研發投入，為客戶提供完整的端側智能音頻解決方案。我們計劃聚焦工藝升級，並向機器人生態躍進。我們將通過超低噪聲結構設計，進一步實現MEMS麥克風信噪比性能躍升；強化端側AI能力（降噪、語音喚醒、聲源定位），向機器人領域延伸技術儲備。

深化重點領域客戶合作，持續拓展新客戶

在功率器件領域，我們的產品已進入全球前十大新能源汽車製造商中的八家、全球前五大一級汽車零件供應商中的兩家以及全球前五大AI數據電源供應商中的兩家。我們將持續深化鞏固與全球領先的汽車企業，全球知名汽車零部件一級供應商，以及全球AI數據中心頭部客戶的合作關係。通過提供具備卓越性能的高品質產品，爭取實

業 務

現「一家客戶、多品類、長期合作」的穩定關係。同時，瞄準高速增長的重點行業，我們計劃深耕新能源汽車、AI數據中心等行業並持續發掘新客戶，以強化我們的市場地位。

在音頻芯片領域，我們現有終端客戶已涵蓋全球前五大智能手機供應商中的四家。我們計劃在維護老客戶的同時將積極培育新客戶，聚焦AI、智能可穿戴、真無線立體聲（「TWS」）等其他新興領域的終端客戶，旨在將我們的成功經驗複製到更廣泛及更多樣化的客戶生態系統，這將使我們能夠佔領更多市場份額並優化客戶結構。

探索產業鏈內併購機遇

除內生增長外，我們亦計劃尋求投資與收購機會，以加強整體競爭力，並推動長期可持續發展。具體而言，我們計劃投資或收購具備差異化技術能力、可強化技術組合、促進產品組合擴展或進軍新市場領域的相關產業製造商，例如專精於功率相關模擬芯片設計產品的製造商，以擴大我們的產品組合及市場佔有率。通過將該等外部資源與機遇與我們在創新、產品品質及客戶服務方面的現有優勢相結合，我們旨在不僅提升整體競爭力與市場份額，更致力構建一個更多元化且具韌性的商業模式，以抵禦行業週期性波動，實現可持續的長期增長，從而為我們的股東、客戶及其他持份者創造價值。

加強專業化人才建設

我們堅信，人才是我們核心競爭力及長期發展的基石。因此，我們高度重視建立強大的人才儲備和提升組織深度。為實現這一目標，我們將透過提供具吸引力的激勵機制以及培育開放協作的企業文化，持續吸引全球人才。

在技術人才建設方面，我們計劃通過引進功率器件及音頻芯片領域的專家級工程師與科學家，持續深化核心技術能力。此外，我們亦計劃招募銷售、供應鏈管理及客戶運營等領域的頂尖人才，為發展提供強力支撐。

透過持續強化專業人才儲備，我們將全力推動核心芯片技術突破，並為全球客戶提供本土化支持服務，從而更靈活、更穩定地應對全球市場格局變化。此舉不僅將提升我們的產品競爭力，更有助於深度融入全球汽車電子產業生態系統，強化品牌認知度與影響力。

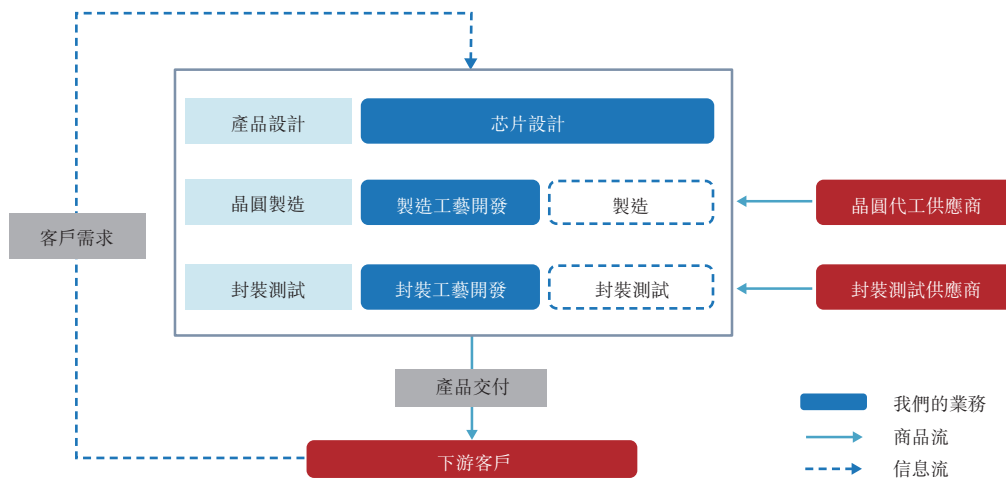
業 務

我們的業務

我們是中國領先的功率器件與音頻芯片供應商，憑藉強大的技術實力及對行業發展趨勢的深刻洞見，以及長期服務眾多全球領先企業所積累的經驗，具有成功的技術變現往績記錄。

我們採用虛擬IDM業務模式，專注於芯片及器件設計以及自主研發的工藝平台，將晶圓生產外包給晶圓廠，並將芯片封裝測試外包給第三方封裝測試供應商。憑藉強大的技術實力和成功的商業化經驗，我們已與供應商建立長期的合作關係，從而實現設計和工藝的協同優化，成功加速產品迭代，這從我們於往績記錄期間的強勁增長和市場拓展中得到印證。

下圖說明我們的虛擬IDM業務模式及參與各方。



我們的虛擬IDM模式在多個方面有別於傳統IDM模式與無晶圓廠模式，此差異使我們在功率器件與音頻芯片產業中的競爭優勢大幅提升。詳情請參閱「行業概覽」。相較於傳統IDM模式，我們的虛擬IDM模式透過外包晶圓環節，避免了管理資本密集型製造設施的負擔，從而顯著降低資本支出。這使我們能專注於芯片設計與銷售，提升運營靈活性並加快產品上市速度。同時，我們仍保持對關鍵專有工藝技術的控制，確保生產與設計的高度匹配，實現產品性能的持續優化。相較於無晶圓廠模式，我們的虛擬IDM模式將專有工藝技術融入晶圓代工生產過程，使我們能有效管控生產環節，確保產品質量和性能。我們的虛擬IDM模式在一定程度上具備流程控制能力，例如能夠依據其專有流程需求，指導晶圓代工廠進行針對性的工藝優化，這與無晶圓廠模式中對外部產能的被動依賴形成對比。這不僅能降低供應鏈風險，還能借助晶圓代工生態系統實現高效產能擴張，增強市場競爭力。

業 務





我們受惠於虛擬IDM模式，這使我們能夠有效控制關鍵的專有工藝技術，同時利用代工生態系統實現經濟高效的擴展，並透過外包標準製造降低供應鏈風險。這種方法在快速發展、定制化驅動的領域(例如新能源汽車、AI數據中心基礎設施及輸電)中表現出色，能夠實現快速的硬件迭代和針對特定應用的優化。

我們的產品種類

於往績記錄期間，我們的收入主要來自設計、開發及銷售(i)功率器件(包括硅和碳化硅功率器件)；及(ii)音頻芯片(包括MEMS產品和信號鏈芯片)，該等產品促進汽車、消費電子以及能源及工業等多個行業實現關鍵功能。我們針對功率器件與音頻芯片產品採用交易型商業模式。下表列出我們於往績記錄期間提供的主要產品。

產品	樣品圖片	主要應用場景
功率器件		
硅功率器件 — 中低壓硅功率器件		
溝槽MOSFET		我們的溝槽MOSFET產品專門用於高頻功率轉換和同步整流控制，廣泛部署於消費性快速充電適配器、電動馬達驅動器、無人機電源系統、汽車LED照明以及低壓DC-DC轉換器。
分離柵溝槽MOSFET		我們的分離柵溝槽MOSFET產品在設備性能、穩定性和安全性方面為汽車行業的客戶提供卓越表現。
硅功率器件 — 高壓與高頻硅功率器件		
FRD產品		我們的FRD產品具有快速反向恢復特性，可有效抑制反向電流並實現快速關斷，適用於高頻開關應用，包括需要高頻續流、整流和緩衝電路功能的應用，例如新能源汽車車載充電器、光伏逆變器和工業變頻器，有助於提高系統效率及優化功率密度。
超級結MOSFET		我們的超級結MOSFET產品有助於滿足客戶對高效率和低EMI不斷變化的要求，使其適用於廣泛的電源應用。

業 務

產品	樣品圖片	主要應用場景
硅功率器件—硅IGBT		
硅IGBT		該等產品廣泛應用於工業變頻及主要家用電器等領域。
碳化硅功率器件		
碳化硅MOSFET		我們的碳化硅MOSFET產品可在汽車及工業應用領域實現更高效率及可靠性。
音頻芯片		
MEMS		MEMS麥克風作為音頻信號鏈前端的主要聲音採集單元，廣泛應用於穿戴式裝置、平板電腦、音箱、AR眼鏡、耳機、智能手機等智能設備。
信號鏈芯片		我們的信號鏈芯片產品廣泛部署於通信、汽車電子、工業控制、醫療設備等產業。

截至2025年12月31日，我們提供約1,855款硅功率器件產品型號、266款碳化硅功率器件產品型號、76款MEMS產品型號及92款信號鏈芯片型號可供出售。

下表載列我們於往績記錄期間按產品劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
收入						
功率器件	383,991	88.7	283,339	74.0	452,809	83.6
— 硅功率器件	368,737	85.2	262,108	68.5	335,074	61.9
— 碳化硅功率器件	15,254	3.5	21,231	5.5	117,735	21.7
音頻芯片	48,743	11.3	99,827	26.0	88,664	16.4
— MEMS	48,454	11.2	98,168	25.6	87,230	16.1
— 信號鏈芯片	289	0.1	1,659	0.4	1,434	0.3
總計	432,734	100.0	383,166	100.0	541,473	100.0

業 務

於2023年、2024年及2025年，我們完成的訂單價值分別為人民幣432.7百萬元、人民幣383.2百萬元及人民幣541.5百萬元。截至2025年12月31日，我們的在手訂單價值為人民幣418.9百萬元。

下表載列我們於往績記錄期間按應用領域所產生的收入：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
汽車	145,293	33.6	57,371	15.0	204,781	37.8
消費電子	104,301	24.1	220,998	57.6	249,855	46.1
能源及工業	183,140	42.3	104,797	27.4	86,837	16.1
總計	<u>432,734</u>	<u>100.0</u>	<u>383,166</u>	<u>100.0</u>	<u>541,473</u>	<u>100.0</u>

硅功率器件

硅功率器件通過調節電路中的關鍵物理特性(如電壓、電流、頻率及開關狀態)，實現高效電能轉換，並在能源轉換、輸配、檢測與監控中發揮核心功能。該等硅功率器件在工業、汽車及消費電子應用中兼具效率、可靠性與成本優勢，對確保電子產品正常運作至關重要。於往績記錄期間，我們提供三大類硅功率器件：(i)中低壓硅功率器件，主要包括溝槽MOSFET與分離柵溝槽MOSFET產品；(ii)高壓高頻硅功率器件，主要包括FRD與超級結MOSFET產品；及(iii)硅IGBT產品。

中低壓硅功率器件

於往績記錄期間，為滿足客戶在中低壓應用場景的需求，我們提供溝槽MOSFET和分離柵溝槽MOSFET產品。每種產品均採用獨特的結構技術，讓其能夠適應中低壓範圍內的各種應用場景。與溝槽MOSFET相比，分離柵溝槽MOSFET通常具有更低的開關損耗和電阻，從而提供更穩定的性能。我們的產品作為電壓控制開關，可在快速開關和最小能量損耗至關重要的電路中有效管理功率傳輸，廣泛應用於各種場景，包括汽車(低壓應用，覆蓋底盤、熱管理、低壓電池、車身控制、域控制器)、AI數據中心電源、智能手機快速充電器、電源適配器、工業電源、電動工具、小家電及機器人。

我們溝槽MOSFET及分離柵溝槽MOSFET產品的主要特點包括：

- **溝槽MOSFET**。透過我們的專有深溝槽閘極結構技術，我們在硅晶圓上蝕刻垂直溝槽並於內部形成閘極，實現更高的元件單元密度與卓越的導通性能。我們的產品涵蓋-40V至100V電壓範圍，具備毫歐姆級超低導通電阻(R_{ds(on)})，能有效降低導通損耗。同時透過優化閘極電荷(Q_g)與輸出電容(C_{oss})設計，最

業 務

小化開關損耗並提升高頻操作效率。產品支持 -55°C 至 175°C 工業級操作溫度範圍，並採用增強型靜電放電防護設計，確保在嚴苛應用環境中的長期可靠性。特別值得一提的是，此項技術結合我們的專有製造工藝，能有效實現高良率與穩定量產。配合我們靈活的產能調度與完善的供應鏈管理，使我們具備明顯的成本競爭優勢。

該系列器件專門用於高頻功率轉換與同步整流控制，廣泛部署於消費級快速充電適配器、電動工具馬達驅動、無人機動力系統、汽車LED照明及低壓DC-DC轉換器等領域。這些高性能、高性價比的國產解決方案，能有效支持緊湊高效的電源設計。

截至2025年12月31日，我們提供503款溝槽MOSFET產品。

- **分離柵溝槽MOSFET**。分離柵溝槽MOSFET是溝槽MOSFET的一種特殊版本。它透過增加內部閘極屏蔽電極進一步降低導通損耗，能實現極快開關速度與高電流承載能力。我們的分離柵溝槽MOSFET產品全面涵蓋25V–200V中低壓範圍，透過定制化外延層與優化元胞結構，結合量身打造的製造工藝，使產品能達到全球領先的性能標準。特別是，根據CIC的資料，在25V、30V及80V平台，我們於最後實際可行日期已提供全球領先性能(極低導通電阻)的產品。此外，我們的40V與80V器件在服務器電源同步整流拓撲應用中可實現鈦金級能效。這些產品在透過特殊工藝優化而增加反向恢復性能功能後，可實現軟恢復特性，進一步降低開關振鈴相關的功率損耗，並透過抑制電壓過衝應力峰值提升安全性。我們的產品具備鈦金級能效，直接應對數據中心核心的綠色節能需求，已成為客戶選產品的關鍵考量因素。在數據中心電源領域的客戶應用中，採用我們的MOSFET器件可穩定維持典型負載範圍內的高電源轉換效率。該特性不僅大幅降低電源模塊散熱需求，協助客戶減少散熱系統相關設計成本與材料投入，更能憑藉器件優良的性能特性有效緩解開關相關風險，降低EMI噪聲，提升整體設備運行可靠性。這些性能優勢使我們的產品成為客戶競標大規模數據中心電源項目的核心優勢，支持其在終端招標中獲得競爭優勢。

憑藉我們的精密器件設計與匹配工藝，以及高品質的封裝解決方案，我們的分離柵溝槽MOSFET產品為汽車產業客戶提供卓越的器件性能、穩定性和安全性表現。

截至2025年12月31日，我們提供778款分離柵溝槽MOSFET產品。

業 務

高壓高頻硅功率器件

於往績記錄期間，我們主要提供FRD及超級結MOSFET產品，以滿足客戶在高壓及高頻應用場景的需求，包括汽車牽引逆變器、車載充電器、光伏逆變器、儲能轉換器、電動車充電樁、工業馬達驅動器及工業電源。

我們的FRD及超級結MOSFET產品的主要特點包括：

- **FRD**。我們的FRD產品採用先進的薄化技術，在8英寸工藝平台製造，具備卓越的正向壓降(VF)一致性(可達0.4V範圍)，以及有利於並聯均流的正溫度係數特性。特別值得一提的是，我們的FRD產品透過優化的載流子壽命控制與背面摻雜技術，實現納秒級反向恢復時間、極低的反向恢復電荷以及較軟的反向恢復行為，能有效降低開關損耗，同時減輕反向恢復過程中產生的EMI。該系列產品涵蓋3A至200A的正向電流範圍與650V至1400V的電壓範圍，可支持在-55°C至175°C的結溫範圍內穩定運行。

我們的FRD產品具有快速反向恢復特性，可有效抑制反向電流並實現快速關斷，適用於高頻開關應用，包括需要高頻續流、整流及緩衝電路功能的應用，例如新能源汽車車載充電器、光伏逆變器和工業變頻器，助力系統能效提升與功率密度優化。

截至2025年12月31日，我們提供67款FRD產品。

- **超級結MOSFET**。超級結MOSFET是專為中高壓功率轉換應用而設計的場效傳感器。與傳統的平面MOSFET不同，它們採用垂直摻雜結構(「超級結」結構)，在保持低導通電阻的同時顯著提高了擊穿電壓。此種結構創新實現了傳導損耗最小化和開關速度之間的最佳平衡，使其成為高效率、高功率密度系統的關鍵。

我們採用先進的器件設計和配套工藝來提升性能，包括：(i)特殊的器件結構設計，以優化動態損耗；(ii)多外延製程技術，實現精確的層結構控制、電荷平衡優化和缺陷控制；以及(iii)增強的器件耐用性和EMI性能，並降低電路雜訊。該等特性有助於滿足客戶對高效率和低EMI不斷變化的需求，使其適用於廣泛的電源應用。我們的超級結MOSFET產品組合涵蓋550-700V額定電壓。根據CIC的資料，我們的超級結MOSFET產品在導通電阻與反向傳輸電容等關鍵參數方面已達到全球領先水準。

截至2025年12月31日，我們提供285款超級結MOSFET產品。

業 務

硅IGBT

絕緣柵雙極晶體管(IGBT)是一種功率器件，結合了MOSFET的柵極驅動簡便性與雙極晶體管的高電流處理能力。其作為高功率應用的電壓控制開關，能實現低導通損耗的高能量轉換。相較於普通硅MOSFET，硅IGBT產品憑藉其混合半導體結構，在高功率、高電壓應用領域具有獨特優勢，使其成為600V以上電壓廣泛採用的導通性能解決方案。此外，硅IGBT功率器件憑藉雙極導通機制實現超高電流密度，能可靠處理數百至數千安培的電流。此高電流能力結合穩健的熱穩定性，使硅IGBT產品無需複雜的外部保護電路，即可承受電機啟動浪湧或短路事件等惡劣條件。

硅IGBT產品在應用領域仍佔據大量市場份額，尤其在優先考量高壓功率處理與系統成本而非超高頻作業的領域，包括汽車牽引逆變器、車載空氣壓縮機、光伏逆變器、儲能轉換器、電動車充電樁、工業變頻器及大型家用電器。

我們的硅IGBT產品採用溝槽場截止技術，覆蓋了主流電壓(650V–1400V)規格，最大電流可達150A。於2024年，我們推出了650V S3-T系列產品，該產品採用了先進的微溝槽技術，根據CIC的資料，該產品在最後實際可行日期已達到中國業內先進的電流密度水平。同時，根據CIC的資料，該等產品在阻斷電壓及導通損耗之間達到了最佳平衡，導通壓降(Vcesat)可與世界一線競爭對手的最新一代產品相媲美。該等產品的背面採用載流子壽命控制技術，實現了IGBT器件的快速軟關斷，在降低關斷損耗的同時，有效抑制了關斷電壓衝擊。其亦具備10微秒的強短路耐受能力與高度可控的dV/dt特性。這些優勢使該產品廣泛應用於工業變頻器及大型家用電器等領域。

截至2025年12月31日，我們提供222款硅IGBT產品。

碳化硅功率器件

於往績記錄期間，我們主要提供碳化硅MOSFET產品。碳化硅MOSFET產品由碳化硅晶體製造而成，在作業溫度、耐壓能力、開關速度及功率損耗方面均優於硅器件。這些特性使碳化硅功率器件廣泛部署於要求高效功率轉換的場景，包括汽車牽引逆變器、車載空氣壓縮機、車載充電器、光伏逆變器、儲能轉換器、電動車充電樁、工業電機驅動器、電動車用工業電源、再生能源及工業系統。

我們已於碳化硅MOSFET領域實現重大技術及市場里程碑。我們的碳化硅MOSFET產品已成功進入全球領先汽車製造商的供應鏈。作為國內首家具備8英寸碳化硅MOSFET設計能力的公司，我們將於今年推出新一代平面碳化硅MOSFET，Rsp達到2.3，業界領先。

業 務

我們的平面型碳化硅MOSFET產品涵蓋覆蓋650V–2300V等主流高壓規格，採用平面式閘極技術與高可靠性垂直器件結構。尤其是，我們於2025年推出的最新系列G5碳化硅MOSFET系列實現了重大技術突破，包括(i)透過先進工藝整合達成具競爭力的單位導通電阻，與國際一流友商水平相當；及(ii)透過優化結構與工藝設計降低電容值，同時進一步減少 R_{sp} 。因此，我們的產品具備降低關斷過衝與振蕩、顯著提升電磁幹擾裕度及高 dV/dt 耐受能力等特性，支持高速開關應用場景。此外，該平台新增支持零電壓關斷的產品系列，能顯著改善半橋拓撲應用中的抗串擾特性，並簡化驅動電路設計。憑藉這些優勢，我們的碳化硅MOSFET產品能在汽車及工業應用領域實現更高效率與可靠性。

截至2025年12月31日，我們提供266款碳化硅MOSFET產品。

MEMS

MEMS麥克風通過整合式結構將聲波轉換為電信號，該結構由MEMS聲壓傳感器和低噪音專用集成電路(「ASIC」)組成。ASIC組件有模擬和數字兩種類型，分別對應模擬和數字MEMS麥克風類型。作為信號鏈前端的主要拾音單元，MEMS麥克風在穿戴式裝置、平板電腦、音響、AR眼鏡、耳機及手機等智能化設備中已廣泛應用。

我們的MEMS麥克風採用獨特的振膜紋理設計與排氣結構，在維持高靈敏度的同時，提升靈敏度一致性並展現卓越的機械性能。透過專用的背板沉積與背面蝕刻工藝，顯著降低噪音並盡量減少帶電異物造成的故障，使器件具備更高信噪比(SNR)與更強機械魯棒性。結構獨特的環形保護側壁設計，實現了硅基板、背板與振膜之間的機械力傳遞解耦，確保振膜能獨立運作並展現獨特振動特性，同時有效提升機械可靠性。

我們的MEMS麥克風具備功耗低、體積小、精度高、一致性優、可靠度高，並支持表面貼裝等優點。該等器件於應用時需於複雜環境中持續運作。由於聲學交互作用要求開放的作業環境，MEMS麥克風在機械可靠性、抗風性、抗突發聲壓衝擊以及防水防塵性能等方面均有嚴格要求。

我們憑藉深厚的技術實力及豐富的行業經驗所打造的獨特結構及工藝創新，成功為各類客戶的嚴格可靠性標準提供量身定制的解決方案。截至2025年12月31日，我們的MEMS產品出貨量已達17億顆，產品正逐步進入全球多家領先消費電子及音頻產品品牌的供應鏈。

截至2025年12月31日，我們提供76款MEMS麥克風產品。

業 務

信號鏈芯片

信號鏈芯片是電子系統中的核心組件，是連接真實世界與數字世界的橋梁。這些芯片專注於模擬信號的接收、轉換、處理與傳輸，其功能通常包括放大器、濾波器、ADC、DAC及接口協定轉換等多種組件，於通信、汽車電子、工業控制及醫療設備等行業中佔據大量市場份額。

於往績記錄期間，我們的信號鏈芯片產品主要包括ADC/DAC及編解碼器(codec)。我們的產品部署於汽車智能座艙及機器人等AI驅動的智能設備。該等產品可與MEMS麥克風芯片結合，形成全面的音頻芯片解決方案。

截至2025年12月31日，我們提供92款信號鏈芯片產品。

研發

我們相信，強大的研發實力對我們的可持續發展及成功至關重要。我們確立研發的戰略定位，專注於(i)開展基礎科學研究，旨在構建平台化技術組合，以實現多條產品線的協同研發；(ii)量身定制技術解決方案，以應對行業及客戶特定的挑戰或需求；及(iii)持續推進產品優化及迭代，這對我們實現可持續領先地位尤為重要。

基礎科學研究

我們在基礎科學研發佈局上，力求確保各主要產品線皆能共享晶圓製造合作夥伴、統一的封裝及測試標準，以及車規級可靠性模型，從而減少重複研發投入。

- 就功率器件而言，我們將研發重點放在(i)材料及結構創新，我們投資開發並持續改進全面的材料、器件及工藝模型組合，涵蓋外延沉積、芯片設計至工藝製造整個關鍵流程，著力優化靜態／動態特性。此外，我們特別注重確保靜態／動態特性、導電損耗及熱穩定性等關鍵功能的優化；及(ii)電氣分析及可靠性，針對車規級芯片建立嚴苛測試及可靠性模型，實現晶圓級可追溯性及從製造到封裝的端到端流程控制，確保符合AEC-Q101標準。

業 務

- 就MEMS麥克風產品而言，我們的研發側重於(i)MEMS集成技術研究，通過微機械加工技術實現傳感器與緊耦合ASIC信號處理芯片的集成，優化面積佔用、靈敏度及噪音特性，以支持在複雜及惡劣環境中的應用；及(ii)多物理仿真平台的開發，我們開發及改進耦合聲學-機械仿真工具，通過結構與工藝模擬對原型的聲學性能與物理特性進行預測性驗證。
- 就音頻信號鏈芯片而言，我們的研發重點是開發(i)標準化數字音頻接口，採用低延遲、低噪音數字傳輸架構並集成ADC/DAC模塊，降低對模擬電路的依賴；及(ii)建立可支持第三方算法移植與管線編排的音頻管線開發框架，實現降噪、音頻編解碼器等功能的模塊化集成。

定制化技術解決方案

我們密切研究終端市場的主要挑戰及客戶的具體技術需求，在此基礎上我們投資研發定制化解決方案，精準應對相關客戶的特定需求，藉此建立及提高客戶忠誠度。

- 就功率器件而言，我們著眼於替代能源與新能源汽車行業的客戶需求，為主要戰略客戶開發定制化工藝，並針對汽車、工業及消費性電子等不同產業客戶的需求，制定產業專屬的產品系列，同時針對高度多元化的應用場景，制定產品系列的場景化標準。此外，我們已建立通過CNAS認證的內部實驗室，開發面向牽引逆變器、車載充電機(OBC)、電池管理系統(BMS)、伺服器電源及充電樁等應用場景的專用測試平台，顯著簡化客戶認證流程。
- 就音頻芯片而言，我們注意到行業趨勢正從消費電子性能提升逐步轉向強調邊緣AI功能。順應此趨勢，我們將研發重點放在：(i)聲學性能提升，致力於實現更清晰的語音信號採集及更低的總諧波失真，支持高清錄音、會議系統、遠程拾音及語音喚醒應用；(ii)邊緣AI應用支持，使器件充當實體層聲學接口，為TWS耳機與智慧家居設備提供低延遲音頻輸入通道，實現端側語音辨識算法部署；及(iii)輕量化開發模式，通過自有MEMS-ASIC協同設計平台有效縮短流片周期。

業 務

產品快速迭代

產品迭代有助於我們提升產品可靠性、有效管控成本以及拓寬產品組合，實現應用領域的多元化。為推進研發進程，我們已建立一套植根於閉環數據分析與跨行業協作的持續優化機制。該體系發展以市場為導向，緊密結合用戶回饋，實現產品、技術及流程平台的快速迭代。

具體而言，我們構建故障分析大數據平台，將客戶系統(如電動汽車電驅系統、光伏逆變器)的現場故障數據(包括IGBT柵氧退化、碳化硅MOSFET柵極劣化等)反向回饋至芯片設計流程。這豐富並擴展了產品開發的設計失效模式與影響分析(DFMEA)、過程失效模式與影響分析(PFMEA)及經驗教訓庫，從而提升產品性能及可靠性。

此外，我們建立了多物理場模擬-測試閉環系統：利用技術計算機輔助設計與集成電路通用模擬程序等協同模擬平台，我們能夠進行從芯片級至系統級的熱、機械及電氣性能的全面驗證。基於物理測試資料持續校準模型精度，將雪崩能量模擬誤差從 $\pm 20\%$ 縮小至 $\pm 5\%$ 。

此外，我們建立了多物理場模擬-測試閉環系統，有助於我們利用技術計算機輔助設計與集成電路通用模擬程序等協同模擬平台，進行從芯片至系統級的熱、機械及電氣性能全面驗證。因此，基於物理測試數據持續校準模型精度，我們能夠有效地縮小雪崩能量模擬誤差。

於往績記錄期間，我們的研發活動主要在內部進行，外部協作僅在有限範圍內就產品開發的特定環節提供輔助支持，包括(i)與知名學術機構合作，對若干產品進行測試及可靠性評估；及(ii)與科技公司及設計服務供應商合作，處理音頻算法開發、測試及芯片版圖設計等具體實施任務。該等外部合作範圍有限，主要涉及驗證、測試或實施層面的工作，並不涉及我們核心技術的開發。合作協議的主要條款載列如下：

- **知識產權**：項目所產生的全部知識產權均屬於我們。訂約方履行協議項下的義務時不得侵害第三方知識產權，且若任何第三方聲稱我們的技術侵害其權利，則訂約方應提供完整證據，證明該技術並未侵害任何第三方的合法權利及權益。

業 務

- **保密：**訂約方須對我們提供的所有信息嚴格保密，並對任何違反保密義務的行為承擔責任。本保密條款自信息提供之日起五年內有效。
- **終止：**本協議可經雙方協定後終止，或按協議規定的其他方式終止。

研發團隊

截至2025年12月31日，我們已組建一支由66名成員組成的專業研發團隊，其中約41.8%持有碩士及以上學位。通過長期專註耕耘，該團隊已在功率器件及信號傳感領域的產品設計及工藝開發方面積累深厚專業知識。憑藉在功率器件及音頻IC研發、工藝開發及量產管理方面的綜合專業知識，我們的研發團隊使我們成為國內少數能夠提供端到端行業解決方案的本土供應商之一。於往績記錄期間，我們的研發開支分別為人民幣68.5百萬元、人民幣59.2百萬元及人民幣72.1百萬元，分別佔同期總收入的15.8%、15.4%及13.3%。

我們高度重視人才的招募及留任。我們深知人才是我們未來成功及可持續發展的關鍵。我們透過提供具競爭力的薪酬待遇、福利待遇以及股權獎勵計劃挽留核心管理層及技術人員。我們亦投資培訓項目，以提升核心管理層及技術人員的技能。我們與核心技術人員簽訂不競爭協議，並於勞動合約中訂明保密、發明轉讓及不競爭條款。

倘核心人員提出終止僱傭關係，我們會與其深入溝通，瞭解離職原因及徵求對本公司之意見。我們亦會透過網上招聘、內部推薦及職業介紹所等渠道，招募具備相關知識及技能之候選人，以避免任何核心人員離職可能造成之負面影響。與管理及技術人員達成的協議的主要條款載列如下：

禁止衝突 於受僱期間，僱員不得從事任何其他全職或兼職工作。

發明安排 在適用法律允許的最大範圍內，我們應擁有與僱員於僱傭合約期間內製作、構想或實踐的任何及所有發明(無論是否可申請專利)、著作、掩模作品、設計、專有技術、靈感及資料(全部或部分)相關的所有權利、所有權及權益(包括專利權、著作權、商業秘密權、掩模作品權、特殊數據庫權利以及全球範圍內所有其他類別的知識產權)，且僱員須及時向我們披露所有發明。

業 務

禁止競爭 我們有權單方面啟動離職後長達兩年的競業禁止期。於受僱期間及我們啟動競業禁止期內，僱員不得參與任何競爭行為。

保密 於受僱期間，除履行職責所需外，且於其後所有時間，未經我們事先書面同意，僱員不得披露、泄露、公佈、刊發、傳達、轉讓或以其他方式使任何第三方知悉，或以任何方式使用屬於我們或屬於任何其他人士而我們負有保密責任的任何資料，如技術及商業秘密。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無任何可能對我們的主要研發項目及業務營運造成重大不利影響的法律申索或訴訟。

主要研發項目

截至最後實際可行日期，我們的主要在研項目載列如下：

產品／技術	主要特性	主要應用	狀況	預期完成時間表
高可靠性超級結 MOSFET	一款12英寸車規級超級結MOSFET，具備優異品質因數(FOM)及寬廣安全工作區(SOA)能力。	適用於車載充電器、伺服器電源及電動車充電樁。 憑藉縮減的應用佔位面積與更高效率，該產品可顯著提升系統的整體效率及使用壽命。	試產	2026年 第四季度
音頻編解碼器	具備高保真音頻採集處理、超低功耗及聲源分離算法特性	適用於機器人、智能揚聲器及AI助理。特別在應用此產品時，多方會議機器人或家庭機器人能夠同步處理多名說話者語音，分離其獨立聲源流，實現透過多人對話進行自然交互。	正在進行可靠性評估	2027年 第二季度

業 務

產品／技術	主要特性	主要應用	狀況	預期完成時間表
高頻、高效能 碳化硅MOSFET	一款基於第六代車規級8英寸工藝平台的高頻、高效能碳化硅MOSFET，較上一代產品實現導通電阻(Rsp)降低20%。該產品支持超高開關頻率及高dV/dt的嚴苛工況，具備增強的抗門極串擾能力以確保穩定的零電壓關斷，並在高壓應用中提供更優異的穩健性及可靠性。	車載充電器、電機驅動系統、牽引逆變器、人工智能數據中心電源及超高效率充電站	正在進行可靠性評估	2026年 第四季度
具備卓越性能的硅IGBT	一款650V S4平台IGBT，採用更小的元胞間距以突破性能限制，提供高功率密度，並在低導通損耗與高開關速度之間實現優化平衡。	儲能系統、光伏系統、汽車應用及焊接設備。該產品在功率損耗及可靠性方面實現全面優化，滿足汽車及工業應用的嚴苛要求，並可實現系統小型化及整體性能提升。	正在進行可靠性評估	2026年 第四季度
具有超低導通電阻及卓越動態開關性能的分離柵溝槽MOSFET	基於先進的12英寸工藝平台，較上一代產品實現Rsp降低超過20%。該產品支持雙面散熱及源極朝下配置等先進封裝設計，優化散熱效果並降低器件損耗，從而增強系統級熱管理能力，提升功率密度並實現更緊湊的電路設計，同時降低開關損耗以支持更高頻率運行及高效率。	電機驅動系統、微型逆變器、AI伺服器電源及DC-DC電源系統	正在進行可靠性評估	2026年 第四季度

業 務

研發流程

我們的研發流程依照我們先進的產品質量規劃管理程序執行，確保產品達到最高品質及可靠性標準。此流程涵蓋多個關鍵階段：

- **規劃**：市場部發起新產品需求。研發部需完成競品分析和技術可行性評估，包裝部、應用部等部門參與聯合評審。跨部門簽署會議紀要和研究論證紀要，並通過項目計劃和產品保證計劃的審批，完成立項後進入設計階段。
- **產品設計**：產品設計階段以研發部編製的設計評審為依據，該評審全面涵蓋產品規格、布局設計要點、包裝解決方案及測試計劃。該文件需經過市場部、包裝部、品質部、實驗室等相關部門聯合評審。產品設計過程需完成有效的設計失效模式與效應分析報告、測試程序的初版編製，並完成知識產權風險排查。
- **流程設計**：研發部主導制定晶圓加工流程計劃表。晶圓輸入項取決於設計審查結論與初始測試程序的驗證結果。僅當晶圓測試報告符合設計目標時，研發部方可啟動流程驗證批次輸入項。封裝環節由運營封裝部協調，負責監管材料可用性與試產計劃。啟動封裝的前提是取得經更新的封裝評估報告、最終BD圖及簽核版的測試關鍵指示手冊。
- **驗證**：實驗室完成ATE測試並出具測試與可靠性驗證報告後，產品部必須確認所有測試數據達標且無未解決的故障分析(FA)問題。研發部提交全週期技術文件結案證明，品質部確認流程變更受控，運營部承諾量產資源已備妥。量產准入需簽署《量產審核表》並符合量產標準。產品線工程改善部隨後承接良率監控與客戶投訴應對，完成從研發到量產的移交工作。

業 務

獎項及榮譽

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已就產品、技術及創新獲得多項獎項及榮譽，其中主要獎項及榮譽載列如下：

獲獎年份	獎項及榮譽	頒發機關／機構
2025年	2025年中國汽車芯片創新成果獎— 碳化硅MOSFET	中國汽車工業協會
2024年	2024年上海市重點服務獨角獸(潛力) 企業	上海市中小企業發展服務中心
2024年	2024年第三十三屆中國創新創業大 賽—顛覆性技術創新大賽(領域賽) 卓越項目	中國創新創業大賽
2024年	上海市科技小巨人企業	上海市科學技術委員會、上海 市經濟和信息化委員會及上海 市財政局
2024年	科技成果評估—碳化硅MOSFET達 「國際先進」水平	上海技術交易所有限公司
2024年	2024年「中國芯」優秀技術創新產品 獎—碳化硅MOSFET	工業和信息化部電子信息產業 研究院
2023年	2024年上海設計創新中心(2024 年-2026年)	上海市經濟和信息化委員會
2023年	高科技企業	上海市科學技術委員會
2023年	上海市企業技術中心	上海市經濟和信息化委員會
2023年	國家級「專精特新」小巨人企業	工業和信息化部

業 務

獲獎年份	獎項及榮譽	頒發機關／機構
2022年	浦東新區研發機構	上海市浦東新區科技和經濟委員會
2022年	上海市專精特新中小企業(2023年3月-2026年2月)	上海市經濟和信息化委員會
2022年	上海市科技小巨人(含培育)企業	上海市科學技術委員會
2022年	2022年「創客中國」上海市中小企業創新創業大賽2022年企業組二等獎	上海市經濟和信息化委員會
2022年	2022年上海市重點服務獨角獸(潛力)企業	上海市中小企業發展服務中心
2022年	2022年度21世紀「科創之星」高競爭力企業優秀案例	南方財經全媒體集團
2022年	2022浦東新區創新創業獎	上海市浦東新區人民政府
2022年	2022上海最具投資潛力50佳創業企業	上海市國際股權投資基金協會

我們的銷售網絡

於往績記錄期間，我們的產品主要直接銷售予中國客戶。其次，我們委託經銷商進行銷售，以利用其於客戶關係、銷售網絡覆蓋及特定市場區域滲透率方面的競爭力。下表載列我們於所示期間按銷售渠道劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
直銷	304,331	70.3	278,188	72.6	396,798	73.3
分銷	128,403	29.7	104,978	27.4	144,675	26.7
總計	432,734	100.0	383,166	100.0	541,473	100.0

業 務

直銷渠道

於往績記錄期間，我們向眾多從事半導體及消費性電子產業的客戶進行直銷。於2023年、2024年及2025年，直銷收入分別為人民幣304.3百萬元、人民幣278.2百萬元及人民幣396.8百萬元，分別佔同期總收入的70.3%、72.6%及73.3%。通過直銷，我們能直接掌握客戶需求，藉此強化客戶關係。

下表載列我們與直銷客戶簽訂的標準協議主要條款概要。

期限	我們與客戶簽訂的協議期限通常為一至三年，其中部分協議為長期有效協議。
付款及信貸期限	就買賣協議而言，我們按照雙方協定條款及時間表結算款項，通常採用電匯方式，付款期限為一至兩個月。
定價	我們通常根據採購訂單所協定的產品及服務或雙方確認的報價來釐定價格。
物流	供應商通常應根據合約及採購訂單的規定按時交付貨物，並承擔相關運輸成本。
風險轉移	產品遺失或損毀的風險於買方確認收貨時即予轉移；供應商應承擔運輸過程中產品損毀或遺失的風險。
產品退貨	僅限於不符合買方要求或品質不合格的產品方可退貨。
保修	我們已於合約中明確產品品質保證及違約責任，以及遵守知識產權及保密的義務。
終止	協議可於合約到期時、雙方協定或因交易對手重大違約終止。

經銷商

根據市場慣例，於往績記錄期間，我們亦委聘經銷商進行銷售，藉此利用其渠道資源及服務專業知識，以具成本效益的方式實現快速市場擴張及滲透。於往績記錄期間，我們與經銷商之間為買賣關係。於往績記錄期間，我們向經銷商銷售產生的收入於產品控制權轉移至經銷商時確認。

業 務

截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們分別委聘93名、92名及81名經銷商。於2023年、2024年及2025年，我們向經銷商銷售產生的收入分別為人民幣128.4百萬元、人民幣105.0百萬元及人民幣144.7百萬元，佔同期我們產品銷售收入的29.7%、27.4%及26.7%。

下表載列於所示期間我們的經銷商數量及其變動情況：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
截至期初	39	93	90
新增經銷商	57	27	16
終止現有經銷商 ⁽¹⁾	3	30	25
截至期末	93	90	81

附註：

(1) 指於相應年度並無向本公司貢獻收入的經銷商。

於2023年、2024年及2025年，本公司於各期間末的經銷商數量分別為93家、90家及81家。截至2025年12月31日，期末經銷商數量減少至81家，這主要反映我們對部分經銷商的替換，此舉顯示我們持續努力優化分銷網絡。

據我們所深知，所有經銷商均為獨立第三方。該等經銷商與本公司、其附屬公司、其股東、董事、高級管理層或其各自的聯繫人概無關連。據我們所深知，除與我們訂立的常規經銷安排外，經銷商與本公司、附屬公司、股東、董事、高級管理層或其各自的聯繫人之間概無其他關係。

根據市場慣例，我們主要與經銷商訂立標準經銷協議，標準經銷協議本質上屬買賣協議。下表載列我們與線下經銷商訂立的標準經銷協議的主要條款概要：

期限	我們與經銷商訂立的協議期限通常為一至兩年。
定價政策	經銷商應於訂單中註明終端客戶名稱、單價及總價。
付款及信貸期限	合作付款方式須由雙方另行協商，任何賬戶延期及付款條款的變更均須經電子郵件確認。
最低購買要求	我們通常要求經銷商的每筆訂單數量不得低於供應商先前公佈的產品標準最低訂單數量。我們通常不要求經銷商維持最低庫存水平。

業 務

次級經銷商安排	我們通常不允許經銷商委託次級經銷商。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據董事所深知，我們的經銷商概無委託任何次級經銷商。
風險轉移	經銷商通常需承擔產品自其指定收貨人收到每筆訂單產品之日起遺失或損毀風險，惟因生產設計或其他類似因素導致的品質問題除外。
產品退貨	產品退貨通常未在協議中明確規定適用情形。
終止	經銷協議可因交易對手重大違約而終止。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與經銷商之間並無重大未解決糾紛或訴訟，且我們亦未曾因經銷商嚴重違反經銷協議條款而終止任何合作關係。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未收到來自經銷商的任何產品退貨。

經銷商甄選及管理

我們已制定一套經銷商甄選標準及管理政策，以確保經銷商具備能力、效率及充足資源。經銷商甄選時考慮的因素包括其地域覆蓋範圍、處理功率器件及音頻芯片產品的經驗、營運規模、資歷、現有客戶群及市場聲譽。我們定期審查經銷商的表現，並在與經銷商續訂協議時考慮多項因素，包括其資歷、技術專長、銷售及市場推廣能力、銷售網絡、財務資源及客戶資源。

我們積極管理經銷商，以確保其遵守相關法律法規的要求。我們採納並實施一系列經銷商管理政策，以確保經銷商遵守法律規定。我們的經銷商管理政策通常載有多項營運指引，包括推廣活動及賬目核對機制等。具體而言，我們要求經銷商在取得我們的批准後方可向終端客戶進行初始銷售並與該等客戶開展合作。

於往績記錄期間，我們按個別情況釐定向經銷商提供的定價條款，並經計及(i)經銷商的信用狀況及合作記錄，(ii)相關下游細分市場的市場潛力及競爭格局，(iii)長期合作的潛力，及(iv)授予我們的付款條款及信用條款。

我們認為，我們的銷售反映了終端客戶的實際需求，從而盡量降低分銷網絡內渠道囤貨及庫存積壓的風險，因(i)我們通過定期線上跟進以了解經銷商的存貨水平，藉此掌握現行市況，並核查彼等是否維持充足庫存；及(ii)我們通常不向經銷商提供較長信用期，亦不設定最低採購量要求，以此鼓勵經銷商更審慎地根據實際銷售情況與市場需求進行下單。此外，我們亦實施積極的管理措施，以降低經銷商之間的潛在競爭或市場蠶食情況。例如，我們主要按行業委任及管理經銷商，通常在同行業內聘請兩

業 務

至三名戰略經銷商，以避免資源重疊。此外，我們已實施客戶及項目登記制度，經銷商不得重複登記同一客戶或項目，從而最大程度減少經銷商之間的潛在衝突及重疊。我們相信上述措施，連同上文所述與經銷商訂立的協議條款(包括付款與信貸條款、退貨政策及其他經銷商管理政策)，能有效降低潛在的內部競爭與渠道囤貨風險。於往績記錄期間，我們通常不允許經銷商委任次級經銷商。

我們的境外銷售

於往績記錄期間，我們主要通過於中國的銷售獲得收入。於2024年，我們與一家總部位於德國的全球汽車一級供應商建立合作關係，其主要業務包括汽車零部件、工業技術、消費品以及能源與建築技術的開發及製造，並開始向他們供應碳化硅MOSFET產品。我們通過向該客戶銷售產生境外銷售收入，於2024年及2025年境外銷售收入分別為人民幣4.0千元及人民幣9.0千元。

我們的境外銷售於相關司法權區的現行貿易環境下進行。境外客戶對我們產品的需求以及定價動態，可能受該等市場適用的貿易政策、關稅及市場准入條件所影響。有關詳情，請參閱「風險因素 — 我們面臨與國際貿易政策、出口管制法規、經濟制裁及投資限制有關的風險」。

我們的生產

我們不營運自有製造設施，而是遵循虛擬IDM模式。在此架構下，我們保留產品設計、研發、應用工程及品質保證的內部能力，同時與策略夥伴合作進行光罩製造、晶圓製造、組裝及測試。我們與供應鏈合作夥伴緊密合作，監控生產進度、管理品質控制，確保持續供應以滿足客戶需求。我們進行全面的供應商管理及定期審核，以維持整個生產流程的高標準。我們已與多家信譽良好的晶圓代工廠建立長期穩定的合作關係。詳情請參閱「一 採購」一段。

品質控制

我們致力於持續為終端客戶提供可靠且高品質的產品。尤其憑藉管理團隊深厚的產業洞察力及豐富的實務經驗，我們始終堅定不移地致力於產品品質與可靠性。這促使我們建立全面的總體品質管理系統，涵蓋整個產品生命週期，貫穿端到端流程，包括設計、製程開發、線上監測、缺陷改善、良率管理及品質相關客戶回饋。我們特別成

業 務

立了品質控制團隊，其大部分核心成員各自擁有逾二十年國際領先製造商經驗(其中多名成員擁有六西格瑪黑帶等專業認證)，負責品質控制工作。此外，我們倡導「零缺陷」品質文化，定期舉辦品質控制績效評估活動，以確保全體僱員嚴格遵守品質控制標準。

我們已實施全面的品質保證系統，確保從研發設計到生產的嚴格控制。我們已取得ISO9001品質管理系統認證及ISO26262功能安全認證。我們亦已建立品質控制系統，確保嚴格遵守RoHS/REACH等環境指令及AEC-Q101、AEC-Q001、AEC-Q002等關鍵汽車可靠性標準，並積極實施AEC-Q004框架指引。尤其是我們已成功通過多家全球領先汽車零件供應商及原設備製造商的嚴格品質系統審核。於往績記錄期間，我們的產品品質已獲得頂級汽車電池製造商的高度認可，這有力地驗證了我們品質控制的實際成效。

芯片設計的品質控制

我們認為產品設計是確保品質控制的關鍵環節。由於篩選流程本身就難以識別所有缺陷，我們不再僅依賴篩選流程確保產品品質，而是致力於強化產品設計，恪守以下原則：預留充足餘裕、避免潛在故障點及缺陷風險(包含適當冗餘)、避免追求極端優化。我們在開發各階段融入多功能團隊審查及設計品質團隊評估，確保準確識別並充分滿足客戶需求。我們亦已實施品質回饋機制，通過該機制，我們能逐步完善設計規則，累積寶貴經驗，提升開發成功率，降低研發成本及設計品質事故的可能性。

生產流程品質控制

我們採用虛擬IDM模式運營，將生產外包予外部晶圓代工廠及封裝測試服務供應商。為確保產品品質，我們已建立全面的供應商管理團隊，監督所有生產階段，包括晶圓製造及封裝測試。

在生產過程中，我們每日與代工廠及封裝測試服務供應商保持溝通，並每週召開會議。我們實施多項品質管理措施，例如每周生產線隨機檢查、每月生產報告審查、每季業務總結及年度品質審核。該等措施確保我們維持低產品缺陷率，並滿足下游客戶要求的高可靠性標準。

調整項目品質控制

我們已建立多功能交叉審查團隊機制，全面處理從設計到銷售各階段的變更，確保所有修改均經過全面評估及徹底驗證。此外，我們運用智能ERP系統，實現變更前後的嚴格材料控制。

業 務

產品退貨及保修

除因我方過失或客戶與我們協商一致達成的退貨協議所載的情況導致的品質問題外，我們通常不允許客戶退換貨。於往績記錄期間，我們接獲的產品退貨要求金額分別約為人民幣12.9百萬元、人民幣8.1百萬元及人民幣9.4百萬元。該等產品退貨主要由於經客戶與我們雙方同意後於產品與客戶應用場景的技術整合及調試過程中發現的若干兼容性問題。於往績記錄期間，我們的產品退貨率(按退貨金額佔總出貨價值的百分比計算)分別為2.0%、2.5%及1.7%。我們一般為產品提供一年保修期，在此期間我們提供產品更換及維修服務。於往績記錄期間，我們未發生任何有關產品退貨、產品召回、產品更換或產品責任索賠的事件，有關事件可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

我們的資訊科技

我們相信資訊科技對維持競爭地位至關重要。於往績記錄期間，我們投資發展資訊科技系統，以確保業務管理能充分運用技術優勢，實現自動化、信息化、智能化及數字化。

我們已制定網絡及資訊安全應急計劃，設定妥善處理緊急情況的程序。此外，現行系統網絡及伺服器均配備冗餘機制，以確保系統具備強大的備份及檢查機制。於往績記錄期間及直至最後實際日期，我們的資訊科技系統並未發生對整體業務運營造成重大不利影響的任何重大故障或完全癱瘓。

市場營銷、銷售和客戶

我們的客戶

我們的客戶涵蓋多個行業領域的企業，包括汽車、消費電子、可再生能源及工業應用領域。在汽車行業，我們的客戶主要為領先汽車製造商及其一級供應商。在消費電子領域，我們的客戶主要為手機及家用電子產品製造商。在可再生能源與工業應用領域，我們的客戶主要為從事光伏與儲能逆變器、高壓直流充電樁以及AI數據中心供電的知名企業。於2023年、2024年及2025年，於往績記錄期間各年度，本公司五大客戶分別佔相關年度總收入的45.8%、42.2%及48.3%。於往績記錄期間各年度，我們最大客戶的銷售額佔相關年度總收入的15.8%、11.6%及20.9%。

業 務

下表載列於往績記錄期間我們五大客戶的詳情。

截至2023年12月31日止年度

序號	客戶	背景	經銷商/ 直接客戶	向我們購買 的產品/服務	收入 (人民幣千元)	信貸期及 付款方式	佔總收入 的百分比	與我們開展業 務關係的年份
1	客戶A	一家從事半導體及電子元件銷售的中國上市公司，在深圳證券交易所上市	經銷商	功率器件	68,584	30日 銀行轉賬	15.8	2022年
2	客戶B	一家從事半導體製造及銷售的中國私營公司	直接客戶	功率器件	50,357	30日 賬單或銀行 轉賬	11.6	2022年
3	客戶C	一家從事半導體銷售的中國私營公司	直接客戶	功率器件	37,496	60日 賬單或銀行 轉賬	8.7	2022年
4	客戶D	一家從事半導體銷售的中國私營公司	直接客戶	功率器件	21,016	30日 賬單或銀行 轉賬	4.9	2022年
5	客戶E	一家從事半導體製造及銷售的中國私營公司	直接客戶	功率器件	20,679	30日 賬單或銀行 轉賬	4.8	2020年
	總計				198,132		45.8	

截至2024年12月31日止年度

序號	客戶	背景	經銷商/ 直接客戶	向我們購買 的產品/服務	收入 (人民幣千元)	信貸期及 付款方式	佔總收入 的百分比	與我們開展業 務關係的年份
1	客戶F	一家主要從事聲學模組製造及銷售的中國私營公司	直接客戶	MEMS	44,308	45日 賬單或銀行 轉賬	11.6	2020年
2	客戶G	一家主要從事聲學模組製造及銷售的中國上市公司，在深圳證券交易所上市	直接客戶	MEMS	36,324	60日 銀行轉賬	9.5	2020年
3	客戶A	一家從事半導體及電子元件銷售的中國上市公司，在深圳證券交易所上市	經銷商	功率器件	34,291	30日 銀行轉賬	8.9	2022年
4	客戶D	一家從事半導體銷售的中國私營公司	直接客戶	功率器件	25,699	30日 賬單或銀行 轉賬	6.7	2022年
5	客戶E	一家從事半導體製造及銷售的中國私營公司	直接客戶	功率器件	21,189	30日 賬單或銀行 轉賬	5.5	2020年
	總計				161,811		42.2	

業 務

截至2025年12月31日止年度

序號	客戶	背景	經銷商/ 直接客戶	向我們購買 的產品/服務	收入 (人民幣千元)	信貸期及 付款方式	佔總收入 百分比 %	與我們開展業務 關係的年份
1	客戶H	一家於中國註冊成立的私營公司，從事半導體及電子元件的製造及銷售	直接客戶	功率器件	113,246	60日 賬單或銀行 轉賬	20.9	2024年
2	客戶A	一家於中國註冊成立的上市公司，從事半導體及電子元件的銷售，於深圳證券交易所上市	經銷商	功率器件	53,141	30日 銀行轉賬	9.8	2022年
3	客戶F	一家於中國註冊成立的私營公司，主要從事聲學模塊的製造及銷售	直接客戶	MEMS	38,879	45日賬單或 銀行轉賬	7.2	2020年
4	客戶D	一家於中國註冊成立的私營公司，從事半導體銷售	直接客戶	功率器件	28,888	30日 賬單或銀行 轉賬	5.3	2022年
5	客戶E	一家於中國註冊成立的私營公司，從事半導體的製造及銷售	直接客戶	功率器件	27,516	30日 賬單或銀行 轉賬	5.1	2020年
	總計				<u>261,670</u>		<u>48.3</u>	

截至最後實際可行日期，概無董事、其緊密聯繫人或據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東於往績記錄期間各年度於我們的五大客戶中擁有任何權益。據董事所深知，於往績記錄期間各年度，我們的五大客戶各自為獨立第三方。

銷售及營銷

截至2025年12月31日，我們的銷售及營銷部門共有44名員工，主要負責制定銷售及營銷計劃、識別產品市場、開發客戶、進行商業談判，以及與客戶建立合作關係。於此過程中，我們的銷售及營銷團隊運用跨部門協作機制，將研發、品質控制及客戶服務部門人員納入日常工作體系，以便我們能夠快速回應客戶諮詢，並在必要時提供量身定製的解決方案。

定價

於釐定產品定價時，我們綜合考量多項因素，包括戰略價值與相關客戶的業務關係、同類產品的市場競爭態勢、原材料價格成本、製造複雜度及成本，以及我們的產能及

業 務

庫存。我們相信，憑藉長期建立的客戶關係、產品品質優勢、廣泛的產品應用場景覆蓋率及獨特的客戶價值主張，我們得以在保持市場競爭力的同時，爭取到更高的產品定價。我們會向銷售團隊發佈並定期更新產品建議售價，同時允許其在指定範圍內靈活調整，以確保談判效率。

採購返利

根據行業慣例，考慮到與客戶長期良好的業務關係，我們向客戶提供返利並獎勵彼等在採購金額上取得的成就。返利的具體條件一般通過與各客戶按個案基準討論釐定。相關返利比率參考客戶過往享有的比率釐定，因此相關客戶之間的比率有所差異。於往績記錄期間，分別有零名、三名及三名客戶有資格獲得返利，返利總額分別為零、人民幣1.6百萬元及人民幣2.8百萬元。據CIC告知，本公司有關返利的慣例及內部政策大致與行業慣例相符。

採購

在虛擬IDM商業模式下，我們專注於產品研發及銷售，同時將全部的晶圓生產、IC封裝及測試業務外包予第三方。於往績記錄期間，我們主要向國內知名供應商採購：(i)晶圓廠製造的晶圓，以及(ii)IC封裝測試服務。尤其是，於往績記錄期間，我們已與主要晶圓代工廠建立穩固的合作關係，憑藉彼等在晶圓製造領域的豐富專業知識及技術能力，根據我們的設計生產產品，我們根據相關協議向彼等採購晶圓作為製成品。於採購流程中，我們最初根據實際銷售數據、預期訂單及生產周期制定生產計劃。該計劃將指導晶圓廠進行晶圓製造。生產完成後，大部分晶圓將送至封裝測試服務供應商，根據訂單要求進行封裝及後續測試，最終形成製成品。

我們的業務營運涉及功率器件及音頻IC供應鏈，當中涵蓋晶圓代工廠、封裝及測試服務供應商以及原材料供應商。該供應鏈受不斷變動的國際貿易政策、出口管制法規及其他監管動向所影響。該等政策的變動可能影響行業內半導體相關材料、製造服務或設備的整體可用性、定價或交付週期，進而可能影響我們的採購安排及成本結構。有關詳情，請參閱「風險因素 — 我們面臨與國際貿易政策、出口管制法規、經濟制裁及投資限制有關的風險」。

在整個生產及測試過程中，我們與頂尖晶圓廠及IC封裝測試服務供應商保持緊密合作。此類合作確保我們專有生產工藝無縫實施，並貫徹執行嚴格的品質管控措施。我們亦與晶圓廠共同開發專有生產工藝平台，並根據設計需求持續優化以提升產品製造效能。我們非常重視向具備先進技術、良好聲譽和往績記錄的供應商採購原料和服務，因為我們相信產品品質和生產服務水準會深刻影響我們產品的品質，進而影響我們的品牌聲譽。

業 務

下表載列於所示期間我們的晶圓廠、IC封裝測試服務供應商的數目及變動：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
晶圓廠	4	4	4
IC封裝測試服務供應商	15	20	19

於往績記錄期間，我們的晶圓代工合作夥伴保持穩定在4家，展現我們與主要合作夥伴在核心製造流程上的長期穩定合作關係。我們的集成電路封裝及測試服務供應商則由2023年的15家增至2024年的20家，此主要歸因於我們拓展至新能源汽車及光伏儲能等更高端的應用領域，該等領域對芯片性能及可靠性有更高標準。為此，我們選擇性地增聘了在先進製程技術及車規級封裝等領域具備專業能力的供應商，以支持我們的產品開發及量產需求，並提升供應鏈的韌性。我們的芯片封裝及測試服務供應商數目於2025年小幅減少至19家，主要由於我們根據供應商的技術能力及服務質量進行優化及整合所致。

晶圓及芯片封裝測試服務的潛在價格波動可能由於全球及國內產能、政府法規、供需動態及宏觀經濟狀況等因素而產生。儘管我們在若干採購中的議價能力可能因該等非我們所能控制的因素而受到一定程度的限制，但我們採購及供應的能力仍保持穩定。面對潛在的漲價壓力，我們透過與供應商建立長期合作關係、調整庫存水平，並針對個別情況與客戶保持密切溝通的方式減緩此類衝擊。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們的採購並未出現對營運造成重大不利影響的品質問題或短缺情況。

主要供應商

我們的主要供應商主要包括晶圓、封裝測試服務的供應商。於2023年、2024年及2025年，來自五大供應商的採購額分別佔採購總額的99.7%、98.8%及98.4%。於往績記錄期間各年度，來自最大供應商的採購額佔各年度採購總額的94.9%、93.5%及92.9%。

於往績記錄期間，我們主要向我們的最大供應商採購晶圓，但可能面臨相關風險。請參閱本文件「風險因素—於往績記錄期間，我們對主要供應商存在依賴。我們可能無法隨時以商業上可接受的條款獲得穩定供應，甚至可能完全無法獲得供應」。根據CIC的資料，我們於往績記錄期間依賴有限數量的供應商主要源於中國半導體行業發展早期合格晶圓代工廠集中，此現象乃由於高資本投入、技術門檻及監管限制等准入壁壘所導致。自2019年起，我們已與功率器件行業的領先企業的主要供應商芯聯集成電路製造股份有限公司（「芯聯」）建立長期合作關係，並於2025年1月與芯聯訂立戰略合

業 務

作協議，據此，芯聯將調配資源以滿足我們的採購需求，並努力滿足我們的需求。於往績記錄期間，我們主要向芯聯採購晶圓製造服務，而芯聯則根據我們的設計規格及技術要求採購原料並進行晶圓製造。

我們與芯聯訂立的購買協議的主要條款載列如下。

期限：	本協議有效期為三年。
訂約雙方的主要權利及義務：	我們向供應商提供產品參數、技術規格、生產工藝要求及其他產品需求。供應商根據我們的要求製造晶圓產品。
質量保證：	供應商須交付符合我們指定品質要求及產品規格的產品。
產品退貨：	我們有權因供應商的過錯導致產品不符合我們的產品質量要求或規格，而拒絕接收、要求更換或退貨。
獨家性：	並無獨家性要求。
最低採購額：	供應商並無為我們設定最低採購要求。
終止：	各方均有權按照協議規定的條款(包括發生重大違約時)終止協議。

我們與芯聯訂立的戰略合作協議之主要條款載列如下。

期限：	本協議有效期為三年。
範圍：	合作關係主要涵蓋雙方在產品開發、工程驗證及大規模生產等方面的協作，尤其涉及晶圓及其他適用領域。雙方應因應下游客戶需求，在工藝開發、生產協調及供應支援等環節進行合作。
訂約雙方的主要權利及義務：	我們提供產品開發平台支持、技術支持及付運支持，並在必要時協調生產資源。芯聯與我們合作以滿足客戶需求，並在相關業務安排上優先與我們合作。
終止條款：	任何一方可提前一個月發出事先書面通知終止本協議。
更新條款：	本協議於屆滿時，倘任何一方並無異議，將自動續期兩年。

業 務

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與芯聯的安排未曾遇到任何未能續期或提前終止的情況。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，芯聯的供應並無出現中斷或重大延誤，以致對我們的營運造成不利影響。

近年來，我們逐步擴大供應商基礎並積極發掘潛在供應商以減輕市場波動。具體而言：(i)我們始終積極尋求替代供應商，並於往績記錄期間成功識別及維持符合我們對晶圓生產質量及數量要求的替代供應商。例如，我們自2022年起開始向上海一家供應商採購晶圓，作為芯聯的潛在替代來源。該供應商擁有兩個生產基地，為汽車電子、工業控制及高端消費電子領域的功率器件、傳感器及其他核心集成電路提供製造平台。經過審慎評估，我們認為該供應商提供的晶圓質量及產能能夠滿足我們對產品質量及數量的要求；(ii)我們已致力於分散供應商基礎。倘與主要供應商的合作關係終止，我們相信能及時高效地尋得替代供應商，且此類替代安排不會對我們的業務營運造成重大不利影響。

下表載列往績記錄期間我們五大供應商的詳情。

截至2023年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品/服務	採購額 (人民幣千元)	信貸期及付款方式	佔採購總額的百分比	與我們開展業務關係的年份
1	芯聯集成電路製造股份有限公司	一家從事芯片製造的中國上市公司，在上海證券交易所上市	晶圓	434,015	60天 銀行轉賬	94.9	2019年
2	供應商A	一家從事提供包裝和測試製造服務的中國私營公司	封測服務	18,436	30天 銀行轉賬	4.0	2023年
3	供應商B	一家從事芯片製造的韓國上市公司，在韓國交易所上市	晶圓	1,305	預付 銀行轉賬	0.3	2020年
4	供應商C	一家從事芯片製造的中國私營公司	晶圓	816	預付 銀行轉賬	0.2	2022年
5	供應商D	一家從事提供包裝和測試製造服務的中國上市公司，在全國中小企業股份轉讓系統上市	封測服務	811	30天 賬單或銀行轉賬	0.2	2022年
	總計			<u>456,214</u>		<u>99.7</u>	

業 務

截至2024年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品/服務	採購額 (人民幣千元)	信貸期及付款方式	佔採購總額的百分比	與我們開展業務關係的年份
1	芯聯集成電路製造股份有限公司	一家從事芯片製造的中國上市公司，在上海證券交易所上市	晶圓	396,380	60天 銀行轉賬	93.5	2019年
2	供應商A	一家從事提供包裝和測試製造服務的中國私營公司	封測服務	18,990	30天 銀行轉賬	4.5	2023年
3	供應商D	一家從事提供包裝和測試製造服務的中國上市公司，在全國中小企業股份轉讓系統上市	封測服務	1,345	30天 賬單或銀行轉賬	0.3	2022年
4	供應商E	一家從事提供測試服務的私營公司	測試服務	1,273	30天 銀行轉賬	0.3	2023年
5	供應商F	一家從事提供包裝和測試製造服務的中國私營公司	封測服務	931	30天 賬單或銀行轉賬	0.2	2021年
	總計			418,919		98.8	

截至2025年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品/服務	採購額 (人民幣千元)	信貸期及付款方式	佔採購總額的百分比	與我們開展業務關係的年份
1	芯聯集成電路製造股份有限公司	一家從事芯片製造的中國上市公司，在上海證券交易所上市	晶圓	513,238	60天 銀行轉賬	92.9	2019年
2	供應商A	一家從事提供封裝及測試製造服務的中國私營公司	封裝及 測試服務	16,488	30天 銀行轉賬	3.0	2023年
3	供應商G	一家從事提供封裝及測試製造服務的中國私營公司	封裝及 測試服務	6,310	30天 賬單或 銀行轉賬	1.2	2024年
4	供應商H	一家從事提供封裝及測試製造服務的中國私營公司	封裝及 測試服務	3,952	30天 賬單或 銀行轉賬	0.7	2023年
5	供應商E	一家從事提供測試服務的中國私營公司	測試服務	3,477	30天 銀行轉賬	0.6	2023年
	總計			543,465		98.4	

業 務

截至最後實際可行日期，概無董事、其各自的緊密聯繫人或任何股東(擁有或據董事所知曾擁有本公司已發行股本5%以上)於我們的五大供應商中擁有任何權益。據本公司所深知，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們各年度的五大供應商均為獨立第三方。

供應商篩選及管理

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括(i)晶圓廠及(ii) IC封裝測試服務供應商。在決定與供應商合作時，我們會綜合考量多項因素，包括技術專長、產品產能或服務能力、業界聲譽、財務表現及成本。我們定期對供應商的表現進行審查及評估。如發現重大違規行為或重大品質問題，我們將立即啟動重新評估程序，並可能終止與相關供應商的合約關係。

我們通常與供應商訂立框架供應協議。我們與主要供應商協議的主要條款如下：

期限	我們的協議通常持續有效。
相關各方的主要權利和義務	<p>我們向晶圓代工廠提供產品參數、技術規格、生產流程要求及其他產品需求。晶圓代工廠根據我們的要求製造晶圓產品。</p> <p>我們向封裝測試服務供應商提供晶圓產品、技術規格及其他原料，供應商將按照我們的要求執行封裝測試服務。</p>
付款	我們根據雙方共同協定的條款及時間表結算付款事宜。
質量保證	我們的供應商必須交付符合我們指定的品質要求及產品規格的產品。
產品退貨	我們在協議中尚未明確規定產品退貨條款。
終止	任何一方均有權根據協議中規定的條款終止協議，包括重大違約。

重疊客戶及供應商

於往績記錄期間，芯聯為我們於往績記錄期間各年度的五大供應商之一，為我們的功率器件及音頻芯片產品提供晶圓。根據我們的標準評估程序，芯聯於2019年被選為我們的服務提供商，主要由於其高效能製程平台與堅實的品質管控能力。芯聯需接受我們在服務表現等方面的年度評估。

業 務

客戶H(一家車載模塊製造商，專註於為汽車OEM與一級供應商研發、生產及銷售車載主驅模塊)為芯聯的附屬公司，於截至2025年12月31日止年度為本公司五大客戶之一。我們與客戶H的合作關係乃基於雙方商業考量獨立於芯聯而啟動，原因為我們的碳化硅功率器件產品獲客戶H認可用於其車載主驅模塊產品。合作決定乃由客戶H與我們基於各自商業利益自主達成。

我們與客戶H的正式商業合作始於2024年。客戶H於2024年主要採購硅功率器件及於2025年採購碳化硅功率器件，而我們能夠提供符合所需規格的產品。

芯聯與客戶H之間的商業關係以及我們與各方的交易均屬商業合理，且源於獨立的商業考慮，乃主要由於：(i)儘管客戶H為芯聯的附屬公司，惟芯聯對我們的銷售及客戶H向我們的採購均由各自實體的獨立團隊處理，所有關鍵流程(包括合約簽訂、決策及交易執行)均獨立進行。本公司與客戶H的銷售條款及與芯聯的採購條款之協商均係個別進行，該等銷售與採購彼此間既不相互關聯，亦不以對方為條件；(ii)我們向芯聯採購晶圓製造服務乃基於其在車規級功率半導體製造方面的成熟能力，而我們重視與客戶H的合作，乃因其對碳化硅MOSFET產品的需求，該等產品主要用於汽車主驅動應用，市場需求龐大，而國內供應仍然有限；(iii)本公司董事確認，我們向客戶H進行的所有銷售及向UNT進行的所有採購，均為在日常業務過程中按正常商業條款及公平原則進行；及(iv)我們的採購付款及銷售收款分開結算及獨立入賬，應收款項與應付款項之間並無抵銷安排。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度，來自客戶H的收入分別為人民幣6.7百萬元及人民幣113.2百萬元，分別佔各期間總收入的1.7%及20.9%。於2024年及截至2025年12月31日止年度，我們向客戶H銷售的產品毛利分別為人民幣0.3百萬元及人民幣7.3百萬元，而我們向客戶H銷售的產品毛利率分別為3.9%及6.5%。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，芯聯所佔採購額分別為人民幣434.0百萬元、人民幣396.4百萬元及人民幣513.2百萬元，佔各期間採購總額的94.9%、93.5%及92.9%。

客戶E於往績記錄期間的各年度均為我們五大客戶之一，其主要向我們採購中低壓硅功率器件。客戶E於往績記錄期間亦為我們的供應商。於2024年及截至2025年12月31日止年度，我們向客戶E採購包裝及測試服務，用於我們的功率器件產品。於2024年及截至2025年12月31日止年度，我們向客戶E所作的採購額分別為人民幣23,000元及人民幣100元，分別佔採購總額的0.01%及0.00%。於2023年、2024年及2025年，來自客戶E的收入分別為人民幣20.7百萬元、人民幣21.2百萬元及人民幣27.5百萬元，分別佔總收入的4.8%、5.5%及5.1%。於2023年、2024年及2025年，我們向客戶E銷售的產品毛利分別為人民幣1.6百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣2.0百萬元，而我們向客戶E銷售的產品毛利率分別為7.8%、15.7%及7.3%。

業 務

董事已確認：(i)所有與重疊客戶及供應商之間的收入與採購均按一般商業條款於日常業務過程中進行，且彼此之間並不互為條件；及(ii)我們與該等重疊客戶及供應商簽訂的協議條款，實質上與其他客戶及供應商的協議條款相同。據董事所深知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的其他主要客戶與主要供應商之間不存在任何其他重疊關係。

貿易限制對採購及銷售活動的潛在影響

我們的營運依賴半導體供應鏈，當中包括晶圓代工廠、封裝及測試服務供應商，以及零部件、軟件工具及其他輔助材料的供應商。於往績記錄期間，我們並無為核心生產流程採購任何源自美國的零部件或軟件工具。根據我們的內部評估及供應商提供的資料，我們營運中所用的零部件及軟件工具並不受《出口管理條例》規限以致需要就向我們供應取得出口許可證。因此，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因美國出口管制措施而在採購活動中遭遇任何重大中斷、延誤或成本增加。

就我們的銷售活動而言，我們與兩家被列入美國商務部工業與安全局(BIS)實體清單的客戶進行了有限交易。具體而言：(i)我們於2023年9月向其中一家客戶出售在中國境內製造的碳化硅功率器件，該客戶於2024年被列入實體清單，交易總額約為人民幣35,000元；及(ii)我們向另一家客戶出售在中國境內製造的硅功率器件，涉及2024年的三筆交易及2025年的三筆交易，交易總額約為人民幣119,846元。根據我們的國際制裁顧問的意見，由於該等交易不涉及任何受《出口管理條例》規管的物品，因此並未違反適用的美國出口管制法規。該等交易金額相對於我們於往績記錄期間的總收入而言甚微。

儘管如上所述，國際貿易政策及出口管制法規仍可能發生變化，並可能影響半導體價值鏈的不同環節。尤其是我們的供應商(包括晶圓代工廠及封裝及測試服務供應商)在採購原材料、設備或技術時可能面臨限制或更高的合規要求，從而可能影響其產能、交付週期或定價。任何該等情況進而可能導致我們的採購成本增加、供應鏈調整或交付週期延長。因此，儘管我們於往績記錄期間並未因貿易限制而遭遇任何重大不利影響，但出口管制措施進一步收緊或受限制實體清單範圍擴大，均可能透過我們的供應商或客戶間接影響我們的營運，並可能對我們的業務營運及財務表現造成不利影響。

季節性

我們的業務表現並未受到季節性的顯著影響。

牌照、許可證及批准

我們須維持各類牌照、批准及許可證以經營業務。我們持續監控這些要求的遵守情況，以確保擁有經營業務所需的所有批准、牌照及許可證。

業 務

截至最後實際可行日期，據我們的中國法律顧問所告知，我們已取得在中國開展業務營運所需的所有重大牌照、批准及許可證，且該等營業牌照仍具完全效力。我們在中國開展業務營運毋須取得任何其他重大牌照或許可證。於往績記錄期間，我們在重續重大牌照、許可證或批准方面並無遇到任何重大困難，且預期於屆滿續期時亦不會遇到任何重大困難。

知識產權

我們的成功及競爭優勢部分取決於我們開發及保護核心技術及知識產權的能力。我們擁有大量知識產權，包括在中國及美國的專利、註冊商標、軟件著作權及網域名稱。我們亦已採納一套全面的內部知識產權管理規則。該等指引規定我們僱員的義務，並建立與保護我們的知識產品有關的報告機制。我們的法務部門主要負責我們知識產權的保護工作。我們積極管理及擴大我們的知識產權組合，並使用保密及不競爭協議保護我們的知識產權及商業秘密。

截至2025年12月31日，我們在中國有69項註冊專利，在中國有64項專利申請以及在美國有兩項專利申請。截至同日，我們在中國有190項集成電路佈圖設計登記及21項註冊商標(包括香港地區的三項)。此外，為防止核心技術遭海外實體搶先註冊，並鑒於美國授權專利在全球所具有的公信力與價值認可，我們於往績記錄期間在美國提交兩項專利申請。

我們通過自主開發獲得專利。截至最後實際可行日期，我們的所有專利及專利申請均由我們擁有，且並無與第三方共同擁有或共同分享我們的專利及專利申請的安排。然而，如果我們未來無法保護我們的知識產權，則存在風險。詳情請參閱「風險因素 — 我們可能遭受中國或其他司法管轄區的第三方的知識產權侵權和其他索賠，如果成功，可能導致我們支付巨額賠償金及產生其他費用」。

我們可能在部分情況下依賴商業機密及／或保密資料保護我們的技術。我們尋求部分通過與諮詢師、顧問及承包商訂立保密協議來保護我們的自有技術和工藝。我們已與我們的高級管理層、研發團隊的若干關鍵成員以及其他可獲得有關我們業務的商業機密或機密資料的僱員簽訂載有保密及不競爭條款的協議。我們用於僱用我們僱員的標準僱傭合同載有轉讓條款，根據該等條款，我們擁有所有於僱員工作過程中產生的發明、技術、專門知識及商業秘密的所有權利。請參閱「風險因素 — 與我們的知識產權有關的風險」。

我們高度重視知識產權的有效管理與保護，並已實施以下措施：(i)我們已根據國家標準GB/T 29490-2023建立內部知識產權合規管理體系，據此，總經理負責制定相關政策，戰略規劃部門則專責履行知識產權管理職能；(ii)我們將知識產權管理融入核心

業 務

業務流程，包括在提交任何知識產權申請前進行檢索及分析，以確保權利的質量與穩定性、明確界定服務相關成果的所有權歸屬、在日常營運中建立分類知識產權檔案並持續進行維護，以及在僱傭合同及員工行為手冊中明確規定知識產權的所有權及保護條款；及(iii)我們與所有僱員簽訂保密協議，在僱員離職時就知識產權事宜進行提醒與約束，鼓勵僱員在適當保護下舉報合規疑慮，並要求法務部門對任何不合規行為開展獨立公正的調查。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未涉及任何有關知識產權侵權的重大法律、仲裁或行政訴訟或索賠(無論是作為原告還是被告)。董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並不知悉有關我們侵犯第三方知識產權的法律、仲裁或行政訴訟。詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—有關本公司業務的進一步資料—知識產權」。儘管我們做出了努力，我們可能仍面臨被指控侵犯第三方知識產權或我們的知識產權被第三方侵犯相關的風險。請參閱本文件「風險因素—與我們的知識產權有關的風險」。

僱員

截至2025年12月31日，我們共有158名全職僱員，均位於中國。下表列示我們截至2025年12月31日按職能劃分的僱員結構：

職能	截至2025年12月31日 人數	
戰略規劃	19	12.0%
研究與開發	66	41.8%
營銷與銷售	44	27.8%
運營	11	7.0%
質量管理	13	8.2%
法律及合規	1	0.6%
董事會辦公室	2	1.3%
總經辦	2	1.3%
總計	158	100.0%

為精簡人力資源管理，我們制定了一套全面的內部管理措施，其中詳列招聘、培訓、內部推薦等環節的程序與標準。

我們採用多種招聘方式，包括校園招聘、網絡招聘、其他外部招聘渠道，以及內部推薦與調任。我們普遍為僱員提供具競爭力的薪資、績效獎金及其他激勵，並通過市

業 務

場調研持續完善薪酬與獎勵政策。根據中國勞動法律規定，我們參與由當地市及省級政府管理的多項僱員社會保險計劃，包括住房、養老、醫療、工傷、生育、住房公積金及失業保險計劃，並按僱員薪酬的特定比例供款。據我們的中國法律顧問告知，我們已完成社會保險賬戶開立及住房公積金繳存登記程序，並已依照法律法規及主管機關相關規定為僱員繳納社會保險費及住房公積金。於往績記錄期間，我們未曾因違反社會保險及住房公積金相關法律法規而遭受主管機關作出任何重大行政處罰。

我們已建立完善的僱員培訓與發展體系，包括涵蓋企業文化、僱員權利與義務、職場安全、數據安全及其他後勤方面的通用培訓，以及由公司內部講師、外部課程及專家講座提供的專門培訓，以提升僱員在業務相關重要領域的知識與專業技能。

我們確認我們並無勞務派遣僱員，且根據中國法律顧問確認，我們於往績記錄期間未因違反勞動法律法規而遭受主管機關作出任何重大行政處罰。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無發生任何對我們的業務與運營造成重大不利影響的罷工、停工、勞資糾紛或行動。

數據隱私與網絡安全

近年來，數據隱私與網絡安全已成為全球企業的關鍵治理重點。特別是，中國立法與政府機關定期頒佈新的網絡安全、數據安全及隱私相關法律法規。因此，我們在各類數據的收集、處理與傳輸方面的實踐可能面臨日益加強的行政監管。

我們收集並存儲業務運營過程中產生或與此相關的業務數據、管理數據及交易數據，包括與客戶、供應商及其他相關方的業務往來與交易相關數據。我們通常不收集或處理個別客戶的個人信息。

我們已建立完善的數據合規體系，覆蓋網絡安全、數據安全及個人信息保護領域，並配套相應的組織架構與運行機制。具體而言，我們通過內部制度明確數據處理全生命周期的管控要求，並指定相關負責人，統籌推進安全管理工作。此外，我們為僱員提供多種數據安全培訓(包括入職培訓)，以確保僱員充分知悉我們的數據安全政策及其在數據保護方面的責任。我們亦定期為僱員舉辦數據安全培訓及評估。我們設有完善的數據備份系統，通過將數據加密並存儲於位於多個地點的服務器，盡量降低數據

業 務

遺失風險。同時，我們採取了一系列保護網絡安全、數據安全及個人信息的必要技術措施，包括通過採購第三方軟件進行日常病毒掃描、查殺，以防範計算機病毒和網絡攻擊、網絡侵入等危害網絡安全行為。我們使用第三方監控工具對於服務器運行狀態、設備狀態、系統狀態、安全事件等進行監控。我們會針對不同崗位設置不同的操作權限，並按照適用法律要求留存網絡日誌。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，鑒於：(i)我們未發生過重大的數據泄露等安全事件；及(ii)我們不存在因違反法定網絡安全、數據安全、個人信息保護義務被監管調查而受到的行政處罰，或引起爭議糾紛而被提起的仲裁或訴訟，誠如我們的中國法律顧問所告知，我們已在所有重大方面遵守與網絡安全及數據保護相關的適用法律法規。

競爭

我們經營業務所在的功率器件與音頻芯片行業競爭激烈，其特點在於下游應用廣泛與產品組合多元化。全球功率器件市場展現穩健增長態勢。按收入計，全球市場規模從2020年的250億美元增長至2024年的317億美元，該期間複合年增長率為6.1%。2023年至2024年的增長相對稍微放緩，乃主要由於供應鏈限制及終端市場需求暫時疲軟。預計到2029年將達514億美元，2024年至2029年間的複合年增長率為10.2%。受消費電子升級、智能語音應用的普及及汽車智能化加速推動，音頻芯片市場持續擴大。按收入計，全球音頻芯片市場規模從2020年的68億美元增長至2024年的79億美元，複合年增長率為3.8%。預計到2029年將達100億美元，2024年至2029年間的複合年增長率為4.8%。

在市場上的核心競爭力在於技術實力以及從設計、製造乃至客戶協同等全流程的累積能力。儘管身為頭部競爭對手中成立時間最晚的企業，本公司已迅速崛起為中國功率器件及音頻芯片行業的新興競爭力量。我們將繼續專注於運用我們的研發能力、平台化產品佈局及技術專長，以維持並提升我們在市場上的地位。

保險

我們認為我們現有投保保險範圍符合行業慣例，且足以覆蓋重點資產、設施及負債，包括但不限於所有財產相關風險保險、貨物運輸保險、僱主責任險與產品責任險。根據中國法律法規要求，我們為僱員投購的社會保險包括養老保險、生育保險、失業保險、工傷保險、醫療保險及住房公積金。此外，我們亦為僱員購買商業醫療補充保險與意外險。我們按類型與金額投購保單，我們認為其足夠，並根據過往經驗、生產變化及

業 務

行業發展不時評估該等保單。於往績記錄期間，我們未就業務提出任何重大保險索賠。請參閱本文件「風險因素 — 對於我們可能面臨的責任或損失，我們的投保或許並不足以覆蓋，因此，倘出現任何此類責任或損失，我們的業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大不利影響」。

物業

我們的總部位於中國上海，並於中國境內租賃若干土地及樓宇用於業務營運。

自有物業

我們的中國法律顧問確認，截至最後實際可行日期，我們並無擁有任何土地及物業。

租賃物業

截至最後實際可行日期，我們在中國租賃五處物業，總建築面積約5,973.73平方米，用作辦公室、倉庫及研發實驗室。

截至最後實際可行日期，我們已租賃的五處物業中的兩處(總建築面積為2,500平方米)尚未向中國相關土地及房地產管理部門完成登記備案。兩處租賃物業的業主未能向我們提供有效的物業所有權文件或登記所需之其他必要文件，因此我們無法為該等兩處物業登記租賃協議。根據我們中國法律顧問的意見，該等租賃協議未完成登記備案不會影響其法律效力，亦不影響我們依據租賃協議對租賃物業的合法有效使用。然而，相關機關可能要求我們在限期內整改此不合規情況，倘若我們未按期完成整改，我們可能須就每處物業被處罰款人民幣1,000元至人民幣10,000元。於往績記錄期間，我們並未曾因未完成租賃協議的登記備案而遭受主管機關處以任何行政處罰。基於以上所述，我們的中國法律顧問及我們均認為，未完成租賃物業登記備案不會對我們的運營及財務狀況產生任何重大不利影響。

法律程序及合規

法律程序

我們或會不時在日常業務過程中涉及法律程序。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未面臨任何可能對我們的整體財務狀況或經營業績構成重大不利影響的索賠、損害賠償或損失。截至最後實際可行日期，我們並無面臨對我們構成威脅的重大訴訟、仲裁或行政程序。

業 務

監管合規

我們致力遵守適用於我們業務的法律及法規。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無發生任何董事認為單獨或整體而言會對我們整體的業務及營運造成重大營運或財務影響的違規事件。

新冠疫情的影響

自2020年第一季度起，新型冠狀病毒疫情的爆發已對全球經濟造成重大不利影響。為保障公共衛生及公眾利益，中國政府及其他國家政府實施了多項防疫措施。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的生產活動並未因新型冠狀病毒疫情而受到重大干擾，亦未因疫情而令辦公場所或生產設施臨時關閉或停運。

因此，本公司董事認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，新型冠狀病毒疫情的爆發並未對我們的業務、財務狀況或經營業績產生任何重大不利影響。然而，我們無法保證未來的營運或生產活動不會因疫情或其他事件而受到影響。請參閱「風險因素—我們可能受到自然災害、戰爭或者恐怖主義行為或超出我們控制範圍的其他因素的影響。」有鑒於此，我們計劃保持警惕，並將根據未來新型冠狀病毒疫情的發展，密切監測及評估市場狀況。

環境、社會及管治(「ESG」)

環境、社會及管治

我們致力於促進可持續發展實踐，推動社會責任並維持強有力的管治標準，體現我們對環境、社會及管治(「ESG」)原則的恪守。我們已根據上市規則載列的規定採納ESG政策，識別、分析及披露重要的ESG事宜。

我們的業務及設施遵守廣泛的環境、健康及安全法律法規。同時，我們致力於為所有員工創造正向的工作環境。我們高度重視員工安全和福利。我們定期為員工開展相關技能培訓，以提升工作場所安全。我們的董事會下設的ESG委員會監督企業管治措施的有效執行。

ESG治理

ESG事項的重要性評估

我們構建了科學規範、體系完備的ESG重要性評估機制，通過系統性的內外部分析研判，精準識別關鍵的可持續發展議題。在內部評估層面，我們深入剖析企業運營的全流程，嚴格對標國際ESG標準、行業最佳實踐及評級機構的具體要求。在外部評

業 務

估層面，我們持續追蹤政策法規的動態變化，並定期開展利益相關方調研，全面掌握客戶、供應商及投資者等各方的期望與訴求。評估過程中，我們既關注各議題對企業經營的實際影響，也對其給社會環境帶來的潛在影響在程度、範圍及持續性上進行綜合研判。經過多維度的整合分析，我們將重點聚焦於以下核心ESG領域：能源管理、排放與廢棄物管控、員工發展與職業健康安全、可持續供應鏈建設、產品責任等關鍵方向。依託動態化的評估機制，我們能夠精準把控各議題的優先級排序，科學調配管理資源，確保ESG戰略與業務發展、利益相關方期望實現協同推進。

ESG治理

我們致力於將ESG深度融入芯片設計基因，通過技術創新驅動綠色低碳轉型，構建半導體行業可持續發展標桿。我們充分意識到我們有責任促進企業社會責任並將其融入我們業務運營的所有主要方面。我們致力遵守ESG報告規定，並致力以保護環境及員工健康與安全的方式開展業務。為有效管理ESG問題，我們根據《上市規則》附錄C2的標準，建立了一套ESG政策，概述(其中包括)(i) ESG事項的適當風險管治，包括氣候相關風險及機遇；(ii) ESG策略制定流程；(iii) ESG風險管理及監控；(iv) 關鍵績效指標(「KPI」)的確定；及(v) 相關測量與緩解措施。

在ESG管理方面，我們的董事會下設ESG委員會，由獨立董事主導，聚焦三大核心職能：戰略推進 — 統籌ESG目標與芯片技術路線圖的協同落地；風險監督 — 深度監控供應鏈倫理、數據安全及氣候應對議題；績效評估 — 定期審閱ESG關鍵進展並向董事會匯報。ESG委員會聯動技術、供應鏈、人力資源三大部門，形成「戰略 — 執行 — 反饋」閉環。我們的董事會將監察我們的ESG系統，並對設立、採納和審查本公司的ESG願景、政策和目標承擔整體責任。董事會定期聽取ESG里程碑進度簡報，引入獨立第三方對關鍵議題開展持續評估。

董事會制定了清晰的短期目標與中期及長期策略，確保公司在減碳、資源循環、供應鏈管理及信息披露等關鍵領域取得實質性進展。短期階段，建立覆蓋全價值鏈的ESG風險管控基線，強化供應鏈責任溯源能力；中期階段，顯著提升芯片能效水平，持續優化人才結構多樣性；長期階段，引領半導體產業循環經濟模式，成為全球ESG治理典範企業。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因違反有關環境、社會及管治法規而遭受任何處罰。

業 務

ESG 風險管理及策略

我們深知業務運營會受到ESG相關風險的影響，因此持續優化ESG風險管理及機遇識別體系。在過往業績記錄期間，我們未因環境、社會及治理相關事宜的不合規，遭受過對財務狀況或業務運營造成重大不利影響的罰款或其他處罰。

我們積極監測可能影響業務、戰略及財務表現的環境、社會及氣候相關風險與機遇。這主要通過行業報告、客戶反饋及政策追蹤(例如中國「雙碳」目標)進行識別，並未採用定量情景分析。我們已設立ESG團隊，負責監督及評估氣候相關因素潛在的短期、中期及長期影響。在制定業務戰略時，我們會將這些因素納入考量，並可能根據不斷變化的環境、社會及氣候相關情況，調整在特定國家、地區或城市的戰略規劃。

氣候風險和應對

對業務營運的影響

我們認識到全球氣候變化正對經濟與社會發展產生不利影響。氣候變化給我們業務帶來的主要風險可分為物理風險與轉型風險兩類：其中，物理風險主要源於極端天氣(如暴雨)或自然災害(如洪水)可能引發的實質性影響，這類風險可能導致上游生產中斷或受阻。東南亞封裝廠洪澇頻發，屬於短期風險(<1年)，或中斷晶圓供應鏈，影響短期現金流。轉型風險則主要來自向低碳經濟轉型過程中，政策、法律、技術及市場等外部環境出現的廣泛變化。歐盟《芯片法案》碳足跡門檻提升，帶來短期風險(1-3年)，可能導致出口芯片額外繳納碳關稅，增加資本支出。為管理氣候變化帶來的不確定性與各類風險，我們正著力提高資源利用效率、推廣綠色技術創新，並持續提升供應鏈的可持續性。

氣候變化亦會給我們的業務帶來一些轉型機遇。全球新能源汽車的爆發式增長帶來中期機遇(3-5年)，推動了高能效碳化硅芯片需求，進而推動中長期融資吸引力提升。綠色債券發行的成本優勢則屬於長期優勢(>5年)，ESG評級提升可降低利率50-80基點。我們認為，ESG治理在抓住轉型機遇方面發揮著關鍵作用。

對財務表現的影響

截至最後實際可行日期，氣候相關風險並未對我們的財務狀況、經營業績或現金流量產生任何重大不利影響。鑑於本公司採用輕資產業務模式，我們並未面臨直接的物理風險(例如極端天氣事件導致生產設施受損)。目前未有跡象表明，氣候相關風險將於下一報告期間對我們的財務報表中資產或負債的賬面值產生重大調整。

業 務

全球能源轉型加速預計將推動新能源客戶需求持續增長，這可能對我們的財務表現產生積極影響。儘管我們目前並未設立專門的氣候相關投資項目，本公司的研發工作自然契合與新能源相關的半導體應用。該等開支通過經營現金流及[編纂][編纂]提供資金，無需額外的氣候專項融資。總體而言，我們認為由氣候相關機遇(如政策激勵與市場擴張)所產生的潛在財務影響，預計將超越氣候相關風險所帶來的影響。

對戰略的影響

氣候相關風險與機遇已通過產品方向與市場定位對本公司戰略產生影響。本公司當前的戰略聚焦於新能源與高效能領域，其碳化硅MOSFET、硅IGBT及硅MOSFET等產品已應用於光伏逆變器、車載充電器及服務器電源。

本公司計劃進一步優化其產品組合，以把握綠色經濟所帶來的機遇，且無需對其業務模式進行重大調整。儘管目前並未制定直接緩解措施，但我們通過將我們的產品應用於光伏、電動汽車充電及數據中心系統的能效提升，間接為減排作出貢獻。目前，現有資源主要分配於新能源相關半導體產品的研發，且預期無額外資源需求。本集團並未設立具體的氣候相關指標(如減排目標)，乃因其直接環境影響甚微。然而，從定性角度而言，本公司產品於新能源領域的應用有助於客戶實現減排，從而間接支持緩解氣候變化的努力。

員工關懷與福利

為應對員工關懷和福利相關的風險(如僱員滿意度下降或不遵守勞動法律或法規)，我們始終遵守適用的勞動法律和勞動標準。我們制定了《導師管理制度》，幫助新員工儘快瞭解公司、認同公司，進入工作角色。我們為在職員工制定了員工培訓計劃以提升員工能力。除了基本的薪資、社保公積金以外，根據績效考核結果發放獎金激勵以及股權激勵。我們還提供了餐補、額外的福利年假、員工活動經費等提升員工滿意度。

研發和技術創新

我們為員工提供知識產權相關培訓，並對我們的知識產權管理系統進行認證，以保護我們的研發成果。我們根據主要產品技術進行產品專利佈局，維護公司知識產權，並獲得了知識產權管理體系認證證書。

業 務

客戶權益保護

為應對未能保護客戶權益導致的法律或監管責任風險，我們已制定並實施《社會責任管理手冊》以維護客戶合法權益。我們旨在提高客戶滿意度，維持高服務標準，並提升我們在產品和服務卓越性方面的聲譽。

信息安全和隱私保護

我們面向企業客戶(B端)提供服務，不直接面對消費者，因此不涉及消費者相關的信息安全相關政策。

商業道德

維護強烈的商業道德，對於維持持份者的信任及確保長期的可持續經營是不可或缺的。與貪污、賄賂或不遵守行業標準等不道德行為相關的風險，可能會損害我們的聲譽及財務表現。為了降低這些風險，我們遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國反壟斷法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等反腐倡廉、商業道德相關法律法規，制定了《商業道德行為準則》並由員工簽署。

環境保護

作為虛擬IDM半導體設計公司，我們自身並不經營晶圓廠或製造設施。然而，我們深明我們在減少營運和供應鏈環境影響方面的責任。

能源管理

作為企業可持續發展戰略的核心組成部分，能源管理工作在公司運營中佔據重要地位。我們不僅將提升能源使用效益視為環保責任，更將其作為提升運營效率和核心競爭力的關鍵舉措。我們與代工廠、封裝和測試夥伴密切合作，鼓勵環境可持續實踐和遵守相關環境法律法規。我們嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，為有效降低公司管理成本、開源節流，保證合理、有效的使用公司資源，結合公司實際情況，特制定《行政節能減排降耗管理辦法》，建立健全節能減排宣傳機制，不斷提升全員的節能降耗意識。

業 務

為全面掌握並優化環境影響，我們持續監測關鍵環境指標。下表載列於所示期間我們的主要能源消耗情況。

指標	單位	截至12月31日止年度			
		2023年	2024年	2025年	
能源消耗	汽油	升	2,100.0	3,300.0	4,350.0
	電能	千瓦時	498,129.0	704,055.0	628,075.0

用水管理

我們制定了《行政節能減排降耗管理辦法》，強化節水意識、加強用水設備的日常維護管理。下表載列於往績記錄期間我們的用水量：

指標	單位	截至12月31日止年度			
		2023年	2024年	2025年	
水資源消耗	總耗水量	立方米	1,710.6	1,482.2	1,092.3

企業資源管理

在製成品所用包裝材料方面，我們盡力減少材料的使用，並儘量選擇環保材料。本集團產品的包裝材料主要包括紙盒、鋁箔袋、紙箱和泡棉，2025年度本集團所用的製成品包裝材料總量約為4.8噸，其中消耗紙盒約2.9噸，消耗鋁箔袋約0.6噸，消耗紙箱0.4噸，消耗泡棉0.1噸，其他剩餘種類匯總約0.8噸。

排放和廢棄物管理

在溫室氣體排放方面，由於我們業務的性質，我們並未產生與工廠生產直接相關的溫室氣體排放。在廢物管理方面，由於我們業務的性質，我們並無有害廢物，我們按照地方部門的要求推廣無害廢物分類，並在辦公區域為員工提供分類垃圾桶，之後將全部垃圾轉交物業服務提供商與地方部門進一步處理。

業 務

社會責任

員工

在勞動用工方面，我們嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規。我們制定了《社會責任管理手冊》和《CSR紅線危機響應預案》，包含了禁用童工、禁止強制勞工的條款。我們制定了《職業健康監護管理制度》，分別在2024年和2025年開展了《急救培訓》、《疾病預防技能培訓》、《消防知識培訓》來避免職業性危害。我們為員工提供商業保險。我們每年組織員工年度體檢以進行健康管理。截至2023年12月31日及2024年12月31日，本公司分別有136名及144名全職員工。截至2025年12月31日，本公司有158名全職員工，包括92名男性及66名女性。於2025年，30歲以下員工有61名，30至50歲員工有95名，50歲以上員工有2名。

人才發展與激勵

人才發展體系

我們建立了完善的人才發展計劃。公司在全球範圍開放工作崗位，廣泛聘用全球高素質人才；同時構建系統化培訓體系，通過幹部培訓、研發人員專項培訓、通用素質能力培訓等全面提升員工的專業能力和綜合素質，為公司的持續創新發展提供有力的人才支撐。公司從強化幹部管理培訓、搭建人才交流平台及構建資源支持體系等不同維度賦能管理人才與員工能力培訓：2023年培訓17場，2024年培訓45場，截至2025年12月31日培訓29場。

人才激勵機制

為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司核心團隊的積極性，公司提供有競爭力的薪酬，按法律法規繳納社保公積金，根據績效考核結果發放獎金激勵，並針對績效優秀的員工我們施行股權激勵計劃。

未來，我們將持續優化人才發展體系，完善激勵機制，為員工創造更好的職業發展平台，實現員工與企業共同成長的價值理念。通過系統化的人才培養和激勵措施，我們致力於打造一支高素質、高績效的人才隊伍，為企業可持續發展提供堅實的人才保障。

業 務

職業健康、安全和關懷

我們構建了完善的職業健康安全管理体系。在嚴格執行國家相關法律法規要求的我們制定了《突發事件應急預案及措施》，要求定期進行消防演習(消防演習2023年2次、2024年1次及2025年2次)。同時，我們還制定了《職業健康監護管理制度》、《突發事件應急預案及措施》、《突發公共衛生事件和傳染病疫情應急預案》，成立了自然災害防範及日常管理小組來進行內部監管。

我們高度重視員工安全意識和技能的培養。我們制定了《職業健康監護管理制度》，分別在2024年和2025年開展了《急救培訓》、《疾病預防技能培訓》、《消防知識培訓》來避免職業性危害。過去三年，我們始終無工亡事故。

供應鏈管理

在供應商環境合作方面，我們採取了一系列積極舉措。我們將供應商分為戰略供應商與一般供應商進行年度審核、季度打分和年度打分來評估供應商的績效，主要從質量，交期，工程能力，態度，價格等維度來評分。對於戰略供應商、關鍵供應商和供應商雙方產品線，供應鏈的部門主管帶隊每年會互訪交流業務及路線圖，共同協定雙方未來的合作需求。我們能夠精準識別供應鏈各環節環境及社會風險。公司在針對供應商選擇時，有相應的負責人。供應鏈部門負責尋找供應商、價格談判及簽署保密協議以及建立供應商守則；供應商質量工程師部門負責審核供應商資質，確保符合法規，簽署質量協議，產品變更通知協議和環保協議；研發部門評估供應商環保技術可行性。我們制定了完善的用於篩選新供應商的標準。供應商導入時，我們會檢查其是否通過ISO 14001認證和當地環保部門的排污許可證，且在年度審核環節會進行持續評估。供應商質量工程師年度審核會評估環境和社會責任。該審核對於環境和社會責任不符合項有嚴重程度分級，存在主要或嚴重不符合項的供應商會被要求優先整改，如果整改不合格，供應商質量工程師會上報高層更換供應商。我們還要求供應商簽署有害物質限制指令及化學品註冊、評估、授權與禁限用法規，禁止使用有害物質。

知識產權管理

我們構建了知識產權管理政策及獎勵制度，獲得了知識產權管理体系認證證書。

業 務

反貪污與反賄賂

我們始終堅持廉潔經營理念，嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等國家法律法規要求，建立了全面的合規管理體系。同時，我們制定了《商業道德行為準則》，並完成培訓和廉潔協議的簽署。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，公司、全體員工均未發生任何貪污訴訟案件。

風險管理及內部控制

我們已建立及目前維持風險管理及內部控制系統，其包含我們認為適合我們的業務運營的政策與程序。我們致力持續完善該等系統。我們已在業務與運營的各個方面(如資訊科技、財務申報及內部控制)採納及實施全面的風險管理政策。此外，我們定期對風險管理政策及內部控制措施的實施進行審查，以確保其有效性與充分性。我們堅守營運與管理的合法合規，保障資產安全，並確保財務報告及相關資料的準確性及完整性。我們的承諾延伸至提升營運效率與效力，從而促進本公司戰略發展目標的實現。

我們的董事會負責內部控制系統的建立與定期更新，確保其與我們的戰略目標保持一致，而我們的高級管理層則監督各附屬公司及職能部門對內部控制程序與措施的日常執行。我們的內部審計部門連同董事會審計委員會定期評估我們的內部控制，識別改善領域並確保符合公司政策。